

股票代碼:6515



穎崙科技股份有限公司

WinWay Technology Co., Ltd.

民國一一四年度

年 報

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw/>

本公司網站：<http://www.winwayglobal.com>

中華民國 115 年 04 月 25 日刊印

一、本公司發言人

發言人姓名：陳紹焜

職稱：執行副總經理

聯絡電話：(03)553-7632

電子郵件信箱：Jason.chen@winwayglobal.com

二、本公司代理發言人

代理發言人姓名：李振昆

職稱：執行副總經理

聯絡電話：(07)361-0999

電子郵件信箱：JQ.lee@winwayglobal.com

三、總公司、分公司、工廠之地址及電話

名稱	地址	電話
總公司及高雄一廠	高雄市楠梓區創意南路 68 號	07-361-0999
高雄二廠	高雄市楠梓區加昌路 600 之 12 號	07-361-0999
新竹廠	新竹縣竹北市台元街 38 號之 2 號	03-553-7632
仁武廠	高雄市仁武區文武里仁發二路 27 號	07-361-0999

四、股票過戶機構

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

地址：臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓

網址：www.yuanta.com.tw

電話：(02)2586-5859

五、最近年度財務報告簽證會計師

姓名：高鈺倫、曾國禔會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓

網址：www.kpmg.com.tw

電話：02-8101-6666

六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詣該海外有價證券資訊之方式:不適用

七、公司網址：<https://www.winwayglobal.com>

穎歲科技股份有限公司

目錄

頁次

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	6
一、董事、總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料.....	6
二、董事、總經理及副總經理之酬金.....	14
三、公司治理運作情形.....	18
四、會計師公費資訊.....	58
五、更換會計師資訊.....	58
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，於最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	59
七、最近年度及截止至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	60
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係 之資訊.....	61
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資 事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	62
參、募資情形.....	63
一、資本及股本.....	63
二、公司債辦理情形.....	66
三、特別股辦理情形.....	67
四、海外存託憑證辦理情形.....	67
五、員工認股權憑證辦理情形.....	67
六、限制員工權利新股辦理情形.....	68
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	73
八、資金運用計畫執行情形.....	73
肆、營運概況.....	74
一、業務內容.....	74
二、市場及產銷概況.....	85
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均 年齡及學歷分佈比率.....	93
四、環保支出資訊.....	94
五、勞資關係.....	94
六、資通安全管理.....	97
七、重要契約.....	100
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	101
一、財務狀況.....	101
二、財務績效.....	102
三、現金流量.....	103
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	103
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫..	104

六、風險事項分析評估.....	104
七、其他重要事項:無。.....	109
陸、特別記載事項.....	109
一、關係企業相關資料.....	109
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	109
三、其他必要補充說明事項.....	109
柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	109

壹、致股東報告書

一、114 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

114 年對穎歲來說是卓越的一年，在 AI、HPC、ASIC 帶動下，114 年全年營收再創新高，來到 78.57 億元，較 113 年大幅成長 35.51%，挑戰 80 億元大關；稅後淨利為 16.73 億元，每股稅後盈餘（EPS）為 46.93 元，將近 5 個股本，在 AI 應用快速發展、與全球客戶合作深化、再加上新產品線加速導入市場，為公司掛牌以來，首次營收、獲利連兩年營運創新高。此外，從單月營收來看，全年度單月份營收兩度站上 9 億元，足以顯現公司整體出貨量能持續挑戰新高。

根據 Yole Group《半導體耗材--老化測試和測試座市場監測報告》指出，本公司於 114 年邏輯測試座（Test Socket）全球排名第三；邏輯測試座與老化測試座（Burn-in Socket）併計，全球排第四。

在 AI 應用推動 AI Server、資料中心需求，使 CSP 業者競相投入大型語言模型需求，帶動大尺寸、大封裝、大功耗、高頻高速等測試需求，穎歲提前開發完成 AI、HPC 等相關應用產品組合，AI、HPC 營收占比自 112 年到 114 年維持 50%，與運算應用相關的占比來到 73%，使穎歲為高純度的先進封裝及高階測試介面供應商，為客戶提供完整 AI 及先進封裝相關解決方案，成為 AI 典範的最佳助攻。

從上下半年來看，上半年在 AI、HPC 引領下，AI Server 需求、GPU 相關應用帶動高頻高速測試座（Coaxial Socket）出貨，同時公司積極跨足垂直探針卡（VPC）產品線，在 114 年效益逐季顯現，並且於上半年即達成雙位數營收占比的目標，光是上半年的毛利率、營益率、EPS 皆為掛牌以來最強；下半年部分月份受產品組合影響，然在配合 AI、HPC、ASIC 等應用客戶出貨，高階、高頻高速產品線產能全數滿載；尤其 MEMS 探針卡產品線效益持續放大，下半年營收已占垂直探針卡的 20%，凸顯穎歲在半導體測試介面技術橫向拓展（Scale out）能力，以及 MEMS 探針卡的供貨能量和全球市場能見度。

展望 115 年，穎歲持續投入先進封裝、高階測試相關的測試介面開發，在研發端持續往前瞻技術推進紮根，並因應市場需求拓展相對應的產品線，未來不僅是市占率第一，更將挑戰全球第一大邏輯測試座生產供應商。

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新臺幣仟元

年度		114 年	113 年
項目			
財務收支	營業收入	7,857,179	5,798,096
	營業毛利	3,556,473	2,533,535
	營業淨利	2,069,595	1,368,143
	稅後淨利	1,672,872	1,185,837
獲利能力	資產報酬率	20.16%	19.23%
	權益報酬率	27.92%	26.27%
	純益率	21.29%	20.45%
	每股盈餘(元)	46.93	34.31

(三)研究發展狀況

隨著全球科技應用持續升級，半導體產業於114年仍為數位經濟與智慧應用發展的關鍵基石。台灣在先進製造、晶圓材料、IC 設計及封裝技術等面向具備完整產業聚落優勢，長期於國際市場維持高度競爭力。AI、高速通訊、高效能運算及車用電子等應用快速擴展，使晶片朝向高速化、高整合與高功率密度發展，進一步帶動測試精度與熱管理效能的需求同步提升。

因應高功耗與複雜應用環境，半導體測試階段對接觸穩定性、訊號完整度與散熱控制提出更高標準。穎崙科技專注於測試介面與關鍵零組件技術，涵蓋探針卡、精密彈簧針及溫控模組等核心產品，並持續強化高功率測試下的散熱設計與系統整合能力。同時，公司積極拓展第三代半導體、光電與極端環境測試等新興應用，透過高度客製化的解決方案，協助客戶提升測試效率與產品可靠性，穩健因應半導體產業持續演進所帶來的挑戰。

穎崙在114年度之研發成果包括：

(一) 開發 HyperSocket™ 專用針款，降低探針作動應力，藉此提升產品壽命，並獲得更穩定的產品性能。

(二) 建構 HyperSocket™ 自製產能以降低產品成本，提高產品競爭力。

(三) 開發自製長行程 CRS-P 架構以克服大尺寸晶片平面度問題，與提升產品性價比以符合客戶需求，爭取客戶訂單。

(四) 完成 CRS 磁力成型機之自主研發，整合高精度磁場控制、成型參數即時監測回饋與設備通訊整合技術，並同步建置專屬 CRS 製程之 MES 系統，實現製程參數集中化管理與可追溯機制，有效建構穩定可控之磁力成型製程平台，顯著提升成型一致性與製程穩定度。

(五) 成功開發 CRS-GX 結構並導入 Co-Grounding 架構，大幅提升高頻訊號回流穩定性與測試一致性，有效改善數據可靠度，建立可延伸至先進封裝高速測試的關鍵技術，形成明確的結構差異化優勢。

(六) Open-Short Test Loadbox 推出後，解決傳統電極板設計無法滿足大型封裝 DUT 所衍生之翹曲問題，同步導入 HyperSocket™ 消除 PAD 消耗現象，成功支援客戶訂單導入，提升產品競爭力與市場導入速度。

(七) 優化 HyperSocket™ 設計，並開發 Liquid Cooling System，有效提升高功率(3000W 以上)IC 測試穩定性，同時完成水冷與氣冷雙方案布局，提供客戶多元化熱管理選項，強化高階測試應用競爭優勢。

(八) 推進 HEATCon 系列 Thermal Head 應用至 ATE / SLT 測試領域，並成功將解熱效能提升至 3000W@Tc 100℃，建立下一世代高功率測試關鍵模組能力。

(九) 成功開發 EVAC Heatsink，整合 VC 與 3D VC 架構，大幅提升整體散熱效能至 550W @Tc 70 °C，於競品中脫穎而出，並取得客戶訂單，正式跨入資料中心 / AI 伺服器測試領域，奠定高功率 IC 長期布局基礎。

(十) 完成 355nm UV 雷射技術開發，突破 CNC 機台無法處理之超薄與超軟材料加工限制，成功解決材料撕裂與變形問題，補齊公司量產製程缺口，強化特殊材料自主製造能力。

(十一) 隨著客戶產品多變與測試條件要求提高，已成功導入 MEMS 探針在 CP 前段的 Mass Production 測試，也克服高針數、高耐電流、低接觸力…等條件，對應先進封裝 COWOS 技術製程測試方案，也成功完成在客戶端 Eng 驗證測試，並已開始進行量產製作與量產測試，來滿足客戶 AI、伺服、車用等終端產品；對應市場先進製程，會再有 Fine Pitch 演進、Hybrid、High Speed 的需求不斷攀升，已著手展開開發對應不同需求的針款、混用探針對應，並與客戶討論 Turnkey solution 來匹配各項 High Speed (SI/PI)的需求，以提供全方位不同 CP 測試端探針卡方案來服務對應客戶不同的測試需求。

二、115 年度營業計畫

(一)經營方針

穎崱已成為全球第一大邏輯測試座供應商，然而持續成長的腳步並不因此而放慢，為追求公司中長期成長，穎崱將垂直探針卡 (Vertical Probe Card) 產品線視為重中之重，並且預期為 114 年的主要成長動能，一方面擴大自有產能，另一方面合縱連橫，尋找穩定且可靠的合作供應商。穎崱於去年上半年擴大新竹廠辦產線，並且陸續招募新血；同時先後和關鍵供應商展開合作，包括與日本 Yokowo 簽訂合作備忘錄，雙方將在半導體前段晶圓測試及後段 IC 測試建立策略聯盟，藉此深化產業鏈結，共拓市場機會；並且與全球探針卡製造商龍頭探測 (Technoprobe S.P.A.) 和誠錫科技 (MS SUN Technology Company)，簽訂至少 5 年的三方長期供貨合約，採購 MEMS 探針卡相關產品。

內部與外部雙軌策略下，成效卓著，公司在探針卡產品線不僅如預期達成雙位數營收占比的目標，從 113 年的個位數占比，一躍來到 32%，並跨足微機電探針卡（MEMS）新市場，出貨量持續創高。

在追求新產品線成長的同時，持續打造高階測試座一站購足（Socket-All-in-House），其中，在自製探針產能方面，去年底探針自製量已超越原先設定 350 萬支的目標，115 目標將月產能拉高至 600 萬支針。

為滿足強大 AI 運算和訓練效能所需的大尺寸封裝晶片需求，穎崴的跨世代超導測試座 HyperSocket™持續獲得關鍵客戶驗證，其獨一無二的接觸保護設計（Ball Chop Free），能顯著提高測試穩定性，同時實現阻抗精準匹配（Impedance Match），有效降低串擾（Crosstalk Reduction），並大幅提升耐電流能力。

除了 HyperSocket™，相關家族產品線持續發展，包括進階版 HyperSocket™-DF，為市場唯一專為超大封裝（Ultra-Large Package）設計的高階測試座架構，採創新零預壓（Zero Preload Force）設計，能進一步提高整體測試介面效能。

以及導入穎崴自研散熱技術，液冷測試座（Liquid Socket），為市場獨創且領先的大封裝、大功耗、高頻高速的高階測試應用。

同時，為滿足 AI 應用及資料中心客戶強勁需求，公司推出高效能 AI Server 板級測試方案（HPC- AI Server Rack Level Testing Solutions）。

穎崴已在半導體測試介面方案取得技術領先的地位，然而在新一代高階封裝測試蓬勃的發展同時，在電性需求及物理結構上也不斷地面臨新的挑戰。為了使公司產品持續往高階應用推進，公司特別設置 RD-line，用以投入前瞻材料並導入各項新專案小量試產，以滿足市場日新月異的需求。

(二)重要產銷政策

1. 擴大技術自主量能
2. 持續研發新品，聚焦先進封裝、高階測試相關應用
3. 與客戶緊密合作，並於早期與全球晶片大廠共同開發前瞻技術
4. 高階產能立足台灣，即時在地服務全球客戶

三、未來公司發展策略

穎崴持續投入高階晶片相關的測試介面研發、產品開發，提供完整的側式介面解決方案，包括晶圓測試（Wafer Sort）、最終測試（FT）、高頻高速測試系統（SLT）、動態老化測試（Functional Burn-in）、共同封裝光學（Co-Packaged Optics Test Solution）等，迎接 AI Server、高速運算、基礎建設、主權 AI、邊緣運算應用等商機，穎崴 115 年將隨 AI、HPC 大趨勢成長。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

歷經數十年，在穎歲全體員工的努力下，穎歲正式躍居全球第一大邏輯測試座廠商。於此，穎歲並不因此而放慢腳步，反而亦步亦趨的與客戶緊密合作，隨時提供即時在地的技術支援與服務。

為維持穎歲的優勢，除了外聘技術專家，尋求更精密材料的提升，特別設置 RD-line，用以投入前瞻材料並導入各項新專案小量試產，以滿足市場日新月異的需求。

在人才培育方面，穎歲持續投資人才培育與技術研發創新，每年與中山半導體學院有產學合作外；同時重視公司治理，成立永續推動小組，自願性永續報告書，透明公開地向股東、員工、客戶及利害關係人揭露穎歲在永續面的各項作為，其中包含公司治理的透明，優化公司治理架構，並維持董事會的高效運作。

進入 115 年，產業需求仍呈現集中在 AI 需求旺盛、消費及總體經濟疲軟狀態，國際情勢仍充滿不確定性，受惠於 AI 相關高速發展，台灣半導體及資通訊、電子零組件市況緊俏且需求持續強勁，穎歲專注在高階測試介面製造及整合，可望持續成長、維持獲利、並提供客製化高品質的技術支援與服務，為股東創造長期投資效益。

負責人：王嘉煌



經理人：王嘉煌



會計主管：蔡嘉農



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料

(一)董事資料

1. 董事之姓名、性別、經(學)歷、持有股份及性質

115年04月18日；單位：股

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	初次 選任 日期	選任 日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			
董事長	和威投資 股份有限 公司(註1)	-	中 華 民 國	101.10.22	112.6.21	3 年	3,499,559	10.13%	3,499,559	9.71%	-	-	-	-	-	-	-
	法人代表人:王 嘉煌 (註2)	男 61~70 歲	中 華 民 國	90.4.18	112.6.21	3 年	682,820	1.98%	611,820	1.70%	-	-	4,193,210	11.63%	中原大學機械系 福雷電子製造部經理 中華映管工程師	本公司總經理 和威投資(股)公司董事長 威程投資有限公司董事 長 WINWAY TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. 董事 WINWAY INTERNATIONAL CO.,LTD 董事	-
董事	劉燈桂	男 61~70 歲	中 華 民 國	104.2.12	112.6.21	3 年	1,114,962	3.23%	1,114,962	3.09%	-	-	-	-	Rutgers University 電機碩士 普立爾科技總經理	力全興業(股)公司監察人 力親投資(股)公司監察人 力本國際(股)公司監察人	-
董事	李振昆	男 61~70 歲	中 華 民 國	96.8.16	112.6.21	3 年	1,432,155	4.15%	1,365,155	3.79%	-	-	-	-	台灣大學政治系 中華開發信託部經理 晶致半導體財務長 工研院顧問	本公司執行副總經理	-

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次 選任 日期	選任 日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名
董事	陳紹焜	男 61~70 歲	中華民國	104.2.12	112.6.21	3 年	428,053	1.24%	218,053	0.61%	24,667	0.07%	-	-	龍華技術學院電子科 海華科技業務處長 威盛電子產品工程處長 太欣半導體 IC 設計工程師	本公司執行副總經理 磐時電子科技(蘇州)有限 公司總經理	-	-
董事	CHIANG HOCK WOO	男 61~70 歲	新加坡	110.7.30	112.6.21	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	Bachelor of Science for Electrical, Engineering, University of Texas at Austin MBA, Sloan Fellow, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology Senior Vice President- Worldwide Sales & Service , COHU, INC Director – Asia SOC Marketing & New Business Development, TERADYNE (ASIA) PTE LTD Managing Director, TERADYNE SHANGHAI LTD, SHANGHAI, CHINA	Director-SBE Technology Pte Ltd	-	-
獨立 董事	洪秀一	男 61~70 歲	中華民國	109.1.10	112.6.21	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學 法律研究所 台灣雲林、嘉義地方法院 法官 台灣澎湖、高雄、雲林、屏東地 方法院 公設辯護人	洪秀一律師事務所 律師	-	-
獨立 董事	李聰結	男 61~70 歲	中華民國	109.1.10	112.6.21	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學工商管理學系 海華科技(股)公司 董事兼總經 理 威盛電子(股)公司 副總經理	華立捷科技(股)公司董事 長 齊益電子(股)公司董事長 螞蟻數位董事	-	-

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	初次 選任 日期	選任 日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人	
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名
															振華電子股份有限公司獨立董事 ITH Corporation 獨立董事 Brillify Tech GmBH 董事 量捷科技股份有限公司董事長			
獨立 董事	王文信 (註3)	男 61~70 歲	中 華 民 國	109.1.10	112.6.21	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣科技大學 工業管理系 台灣流明光學(股)公司(台灣分 公司) 總經理 揚州揚杰科技(股)公司 首席執行官	美商超微半導體(股)公司 (台灣分公司) 總監	-	-
獨立 董事	張晉誠	男 51~60 歲	中 華 民 國	110.7.30	112.6.21	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	眾嘉聯合會計師事務所 主持會計師 力士科技股份有限公司 董事 弘高投資有限公司董事 金皇投資有限公司董事 京運開發有限公司董事 泓慶開發有限公司董事 永記達漆工業股份有限 公司獨立董事 竣騰科技股份有限公司 獨立董事	-	-	-

(註1)和威投資股份有限公司於107年6月28日解任本公司董事，並於109年1月10日改選重新續任。

(註2)董事長或總經理或相當等級(最高經理人)為同一人、互為配偶或一等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營管理效率與決策執行力，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計畫方針以落實公司治理，本公司於110年股東常會擬增選董事二席(含獨立董事一席)，獨立董事席次由三席提高為四席，以提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

- 1.現任四席獨立董事分別在法律、財務會計及產業領域有專精，能有效發揮其監督職能。
- 2.每年安排各董事參加證基會等外部認證機構專董事課程，以增進董事會之運作效能。
- 3.獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論溝通並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- 4.董事會成員中過半數並未兼任員工或經理人。

(註3)王文信於114.11.24辭任。

2.法人股東之主要股東

115年4月18日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
和威投資股份有限公司	王嘉煌(100%)

3.董事所具專業知識及符合獨立性情形

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董家數
和威投資股份有限公司 代表人:王嘉煌		畢業於中原大學機械系，亦兼任本公司總經理，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，致力於半導體產業相關領域逾30年，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。		0
劉燈桂		畢業於 Rutgers University 電機研究所，曾任普立爾科技總經理，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，專精於市場策略及業務推廣之豐富經驗。		0
CHIANG HOCK WOO		畢業於 MBA, Sloan Fellow, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology，曾任 Senior Vice President-Worldwide Sales & Service, COHU, INC，在半導體行業擁有逾35年的組織領導經驗，專精市場評估規劃、策略管理。	未有公司法第30條各款情事之一。	0
陳紹焜		畢業於龍華技術學院電子科，現任本公司全球業務營運中心副總經理，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，致力於半導體產業相關領域逾30年，擁有全球化業務競爭市場之領導能力。		0
李振昆		畢業於臺灣大學政治系，曾任中華開發信託部經理及工研院顧問，現任本公司財務管理中心資深副總，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工		0

洪秀一	作經驗，擁有豐富企業營運及財務規劃經歷。 畢業於政治大學法律研究所，現任洪秀一律師事務所律師，亦為本公司審計委員會及薪酬委員會召集人，曾任雲林、嘉義地方法院法官，具有5年以上之商務、法務及公司業務所需工作經驗，擁有逾30年以上之專業法律經歷，協助公司法務相關諮詢。	於選任前二年及任職期間，皆已符合下述獨立性評估條件： (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非為公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
李聰結	畢業於臺灣大學工商管理學系，中華民國會計師高師考及格，曾任海華科技(股)公司董事兼總經理，現任華立捷科技(股)公司董事長，亦為本公司審計委員會及薪酬委員會委員，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，除豐富之產業經驗及經營管理能力，且對企業財務分析亦具專業背景。	2	
王文信 (於114.11.24辭任)	畢業於臺灣科技大學工業管理系，曾任揚州揚杰科技(股)公司首席執行官，現任美商超微半導體(股)公司臺灣分公司總監，亦為本公司審計委員會及薪酬委員會委員，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，具豐富之產業經驗及市場策略能力。	0	
張晉誠	畢業於中原大學會計系，中華民國會計師高師考及格，現任眾嘉聯合會計師事務所主持會計師，亦為本公司審計委員會委員，並擔任力士科技股份有限公司董事，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，擁有豐富之會計專業及企業財務經營能力。	2	

4.董事會多元化及獨立性

(一)依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

2、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1、營運判斷能力。2、會計及財務分析能力。3、經營管理能力。4、危機處理能力。

5、產業知識。6、國際市場觀。7、領導能力。8、決策能力。

本公司董事會目前共計8席董事(含獨立董事3席)，整體董事會所具備之能力符合本公司未來發展所需並落實本公司董事會成員多元化政策。

本公司董事會成員中獨立董事有3位(占比38%)，具員工身份之董事有3位(占比38%)，獨立董事的任期年資，3~6年共有3位，董事年齡51~60歲有1位(占比13%)，61~70歲有7位(占比87%)，新加坡籍董事1位(占比13%)

新加坡相宜公司 (已結業)																	
姓名		條件	基本組成				產業經驗								專業能力		
			國籍	兼任員工	年齡		獨立董事年資	半導體	會計及財務分析	專業服務與行銷	資訊與科技	生產製造	行銷管理	風險管理			決策能力
王嘉煌			中華民國	✓		✓		✓		✓			✓	✓			
劉燈桂			中華民國			✓				✓			✓	✓			
CHIANG HOCK WOO			新加坡			✓		✓					✓	✓			
陳紹焜			中華民國	✓		✓				✓			✓	✓			
李振昆			中華民國	✓		✓			✓					✓	✓		
洪秀一			中華民國			✓	3-6年						✓				✓
李聰結			中華民國			✓	3-6年		✓		✓		✓	✓	✓		
王文信(114.11.24 辭任)			中華民國			✓	3-6年				✓		✓	✓	✓		
張晉誠			中華民國		✓		3-6年		✓					✓	✓		✓

5.董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司員工之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
獨立董事席次達董事席次三分之一以上	已達成
非中華民國國籍董事席次至少一席	已達成
任一性別董事席次達三分之一	未達成 (本公司目前董事均為男性，未來將積極規劃女性董事席次，於115年股東會改選董事時，逐步至少規劃一席女性董事，落實性別平等政策)

(二) 總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料

115 年 04 月 18 日；單位:股, %

職 稱	姓 名	性 別	國 籍	就 任 日 期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人		
					股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)			職 稱	姓 名	關 係
董事長兼 總經理 (註)	王嘉煌	男	中 華 民 國	90.4.18	611,820	1.70	-	-	4,193,210	11.63	中原大學機械系 福雷電子製造部經理 中華映管工程師	和威投資股份有限公司董事長 威程投資有限公司董事長 WINWAY TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. 董事 WINWAY INTERNATIONAL CO.,LTD 董事	-	-	-
執行副總 經理	陳紹焜	男	中 華 民 國	102.4.1	218,053	0.61	24,667	0.07	-	-	龍華技術學院電子科 海華科技業務處長 威盛電子產品工程處長 太欣半導體 IC 設計工程師	磐時電子科技(蘇州)有限公司總經理	-	-	-
執行副總 經理	李振昆	男	中 華 民 國	96.5.25	1,365,155	3.79	-	-	-	-	台灣大學政治系 中華開發信託部經理 晶致半導體財務長 工研院顧問	-	-	-	-
副總經理	謝東昇	男	中 華 民 國	112.7.20	-	-	-	-	-	-	淡江大學化工系 台灣積體電路製造股份有限公司 專案經理 矽格股份有限公司 經理	-	-	-	-
副總經理	盧忻杰	男	中 華 民 國	101.7.17	12,680	0.04	-	-	-	-	國立中山大學機械工程碩士 穎威科技製造處經理	磐時電子科技(蘇州)有限公司監事	-	-	-
副總經理	王文信 (註 1)	男	中 華 民 國	115.2.25	-	-	-	-	-	-	穎威科技獨立董事 美商超微半導體(股)公司 (台灣分公司) 總監	-	-	-	-
資深協理	張漢政	男	中 華 民 國	109.9.1	1,290	0.00	-	-	-	-	國立臺北科技大學 工業工程系 海華科技模組產品事業處經理	-	-	-	-
業務協理	高鴻彰	男	中 華 民 國	93.12.22	5,947	0.02	-	-	-	-	私立大華技術學院電子工程科 陽智科技主任工程師	-	-	-	-

職 稱	姓 名	性 別	國 籍	就 任 日 期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人		
					股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)			職 稱	姓 名	關 係
協 理	陳南誠	男	中 華 民 國	112.7.17	-	-	-	-	-	-	中山大學電機工程系 哲庫科技(上海)資深處長 海思(上海)資深處長 聯發科技(股)公司處長	-	-	-	-
處 長	蔡嘉農	男	中 華 民 國	107.5.3	-	-	-	-	-	-	國立成功大學財務金融碩士 南寶樹脂財務總處經理 占暉光學財務長 奇力光電財務經理	-	-	-	-

(註)董事長或總經理或相當等級(最高經理人)為同一人、互為配偶或一等親親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：

本公司董事長兼任總經理，係為提高經營效率與決策執行力，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計畫方針以落實公司治理，本公司於110年股東常會增加獨立董事一席(獨立董事席次由三席提高為四席)以提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

- 1.四席獨立董事分別在法律、財務會計及產業領域有專精，能有效發揮其監督職能。
- 2.每年安排各董事參加證基會等外部認證機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
- 3.獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論溝通並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- 4.董事會成員中過半數並未兼任員工或經理人。

(註1)王文信於115.2.25 新任副總經理。

二、董事、總經理及副總經理之酬金

(一) 最近年度(114年度)支付董事、總經理及副總經理之酬金

1.董事之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註1)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E) (註3)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註1)			A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司
董事長兼總經理	王嘉煌																			
董事	李振昆																			
董事	陳紹焜																			
董事	劉煜桂																			
董事	CHIANG HOCK WOO	-	-	-	-	11,323	95	95	0.68%	0.68%	47,917	324	324	15,956	-	15,956	-	4.52%	4.52%	無
獨立董事	洪秀一																			
獨立董事	李聰結																			
獨立董事	王文信(註3)	2,820	-	-	-	-	376	376	0.19%	0.19%	-	-	-	-	-	-	-	0.19%	0.19%	無
獨立董事	張晉誠																			

(註1)114年度董事酬勞及員工酬勞業經董事會通過，尚未提股東會報告，係按113年度實際配發比例計算114年度擬配發金額。

(註2)係董事兼任員工所領取包括薪資、職務加給、職務獎金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

(1)請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

獨立董事每月領取定額報酬，且不參與年度盈餘分配提撥之董事酬勞，並得由薪資報酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，酌予調整之。

(2)除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

(註3) 王文信於114.11.24辭任。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	洪秀一、李聰結、王文信、張晉誠	洪秀一、李聰結、王文信、張晉誠	洪秀一、李聰結、王文信、張晉誠	洪秀一、李聰結、王文信、張晉誠
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	王嘉煌、陳紹焜、劉燈桂、李振昆、CHIANG HOCK WOO	王嘉煌、陳紹焜、劉燈桂、李振昆、CHIANG HOCK WOO	劉燈桂、CHIANG HOCK WOO	劉燈桂、CHIANG HOCK WOO
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-	-	-
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-	-	-
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	-	-	-	-
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-	王嘉煌 陳紹焜 李振昆	王嘉煌 陳紹焜 李振昆
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

2.最近年度(114年)支付本公司總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)(註2)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		有無來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長兼總經理	王嘉煌	12,535	12,535	540	540	94,858	94,858	23,364	-	23,364	-	7.85%	7.85%	無
執行副總經理	李振昆													
執行副總經理	陳紹焜													
副總經理	謝東昇													
副總經理	盧忻杰													

(註1)114年度員工酬勞業經董事會通過，尚未提股東會報告，係按113年度實際配發比例計算114年度擬配發金額。

(註2)係指各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

(註3)盧忻杰於114.3.1晉升副總經理。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	王嘉煌、陳紹焜、李振昆	王嘉煌、陳紹焜、李振昆
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	謝東昇、盧忻杰	謝東昇、盧忻杰
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	5 人	5 人

3.最近年度(114 年)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	董事長兼總經理	王嘉煌	-	31,374	31,374	1.90%
	執行副總經理	陳紹焜				
	執行副總經理	李振昆				
	副總經理	謝東昇				
	副總經理	盧忻杰				
	資深協理	張漢政				
	業務協理	高鴻彰				
	協理	陳南誠				
	處長	蔡嘉農				

(註1)：114 年度員工酬勞業經董事會通過，尚未提股東會報告，係按 113 年度實際配發比例計算 114 年度擬配發金額。

(二)分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例：

單位：新台幣千元

職稱	113 年度		114 年度	
	酬金總額佔稅後純益之比例		酬金總額佔稅後純益之比例	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	0.93%	0.93%	0.87%	0.87%
總經理、副總經理	4.73%	4.73%	7.85%	7.85%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)董事：獨立董事每月領取定額報酬，且不參與年度盈餘分配提撥之董事酬勞；董事酬勞係依公司章程規定，年度如有獲利應提撥不高於百分之三為之董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，且董事酬勞給付政策係依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參考同業水準後訂定，將董事績效評估之結果納入考量，並經薪酬委員會審議及董事會通過後，提報股東會。董事出席董事會及股東會之車馬費以定額給付。

(2)總經理及副總經理之酬金：經理人之報酬依其對本公司營運參與之程度及個人績效貢獻訂定，經理人酬金包含薪資及獎金，其中薪資參考同業水準以及職稱、職級、學(經)歷、專業能力與職責等項目，獎金係考量經理人績效評估項目(如：目標達成率、獲利率、營運效益及貢獻度)；員工酬勞係依公司章程規定，年度如有獲利，應提撥不低於百分之五，且不高於百分之十五為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，並依據薪資報酬委員會建議分配原則，由董事長依經營績效核定。

訂定酬金之程序，除了參考公司整體的營運績效，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理的報酬。綜上所述，本公司支付董事、總經理及副總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度(114 年度)董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席 次數(B)	委託出 席次數	實際出 (列)席率 (B)/(A)	備註
董事長	王嘉煌	6	0	100%	
董事	李振昆	6	0	100%	
董事	陳紹焜	6	0	100%	
董事	劉燈桂	5	1	83%	
董事	CHIANG HOCK WOO	6	0	100%	
獨立董事	洪秀一	6	0	100%	
獨立董事	李聰結	6	0	100%	
獨立董事	王文信	5	0	100%	115.11.24 辭任
獨立董事	張晉誠	6	0	100%	

其他應記載事項：

- 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用。

(2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

- 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

第九屆第十一次董事會(114 年 2 月 26 日)

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
王嘉煌 陳紹焜	本公司擬捐贈「高雄市 穎崴慈善關懷協會」案	與董事自身有利 害關係	其餘出席董事無異 議照案通過
張晉誠	擬授權董事張晉誠先生 管理內部稽核單位案	與董事自身有利 害關係	其餘出席董事無異 議照案通過

第九屆第十二次董事會(114 年 5 月 7 日)

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
李聰結 張晉誠	解除董事競業禁止限制 案	與董事自身有利 害關係	其餘出席董事無異 議照案通過

第九屆第十三次董事會(114 年 8 月 13 日)

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
王嘉煌 李振昆 陳紹焜 劉燈桂 CHIANG HOCK WOO	本公司 113 年度董事酬 勞分派案	與董事自身有利 害關係	其餘出席董事無異 議照案通過
王嘉煌 李振昆 陳紹焜	本公司 113 年度經理人 員工酬勞分派案	與董事自身有利 害關係	其餘出席董事無異 議照案通過

第九屆第十六次董事會(114 年 12 月 10 日)

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
洪秀一 李聰結 張晉誠	本公司獨立董事報酬調整案	與董事自身有利 害關係	其餘出席董事無異 議照案通過

3. 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	對董事會114年1月1日至114年12月31日之績效進行評估	包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評	(1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 (2)個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 (3)功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

本公司已完成 114 年度董事會及功能性委員會績效評估，評估結果並提送 115/2/25 董事會報告，做為檢討改進之依據，董事會自評分數平均 4.883(滿分 5 分)、董事會成員自評分數平均 4.898 分(滿分 5 分)，顯示整體董事會運作良好;審計委員會自評分數 4.9(滿分 5 分)、薪酬委員會自評分數 5(滿分 5 分)，顯示功能性委員會整體運作良好，符合公司治理之運作。

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：本公司已指定專人負責公開資訊之網路申報作業，處理公司資訊之蒐集及允當揭露工作，網站並設有「投資人專區」，提供發言人聯繫管道，供股東諮詢公司財務、業務相關資訊。

(二)審計委員會運作情形

本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

1. 審計委員會成員專業資格及經驗

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形（註2）	兼任 發委 數	任 行 員	其 公 會	他 司 成	公 審 員	開 計 家
獨立董事	洪秀一	請參閱第9頁至第10頁-董事專業資格及符合獨立性情形							0
獨立董事	李聰結								2
獨立董事	王文信 (註)								(註)
獨立董事	張晉誠								2

(註) 王文信董事已於 114.11.24 辭任

2. 年度主要工作重點彙整如下：

- (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 審計委員會運作情形

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率% (B)/(A)	備註
獨立董事 (召集人)	洪秀一	6	0	100%	王文信董事於 114.11.24 辭任
獨立董事	李聰結	6	0	100%	
獨立董事	王文信	5	0	100%	
獨立董事	張晉誠	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

第二屆第十次審計委員會(114 年 2 月 26 日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
本公司「113 年度內部控制制度聲明書」案	無	經全體出席獨立董事審議通過，提報董事會審議
本公司 114 年度營運計畫及預算案		
本公司 113 年度營業報告書及財務報表案		
本公司 113 年度盈餘分配案		
發行限制員工權利新股案		
本公司內部稽核主管異動案		
配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師暨參考審計品質指標獨立性、適任性評估及委任報酬案		

第二屆第十一次審計委員會(114 年 5 月 7 日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
本公司 114 年第一季合併財務報告案	無	經全體出席獨立董事審議通過，提報董事會審議
解除董事競業禁止限制案		
取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產及供營業使用之不動產使用權資產額度案		
處分營業用機器設備予磐時電子科技(蘇州)有限公司追認案		
申請「花旗(台灣)銀行」借款額度到期展延案		
申請「中國信託銀行」借款額度到期展延案		

第二屆第十二次審計委員會(114 年 8 月 13 日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
修正本公司「薪工循		

環」案	無	經全體出席獨立董事審議通過，提報董事會審議
本公司 114 年第二季合併財務報告案		
修正 114 年度限制員工權利新股發行辦法案		
本公司發行 114 年限制員工權利新股案		
取得子公司營業用機器設備追認案		

第二屆第十三次審計委員會(114 年 10 月 30 日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
本公司擬採購 MEMS 探針產品案	無	經全體出席獨立董事審議通過，提報董事會審議

第二屆第十四次審計委員會(114 年 11 月 12 日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
本公司 115 年度「稽核計畫」	無	經全體出席獨立董事審議通過，提報董事會審議
修正本公司「資訊作業循環」案		
修正本公司「財產管理辦法」案		
修正本公司「關係人交易管理辦法」案		
本公司 114 年第三季合併財務報告案		
本公司擬向金融機構申請信用額度案		
本公司修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則案		

第二屆第十五次審計委員會(114 年 12 月 10 日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
本公司因應市場需求、充實營運資金，擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案	無	經全體出席獨立董事審議通過，提報董事會審議

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情形

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通事項:

日期	溝通重點	獨立董事意見
114/2/26	內部稽核主管就113年Q4稽核業務執行情形報告 內部稽核主管就113年度內部控制制度聲明書討論及溝通	無異議 無異議
114/5/7	內部稽核主管就 114 年 Q1 稽核業務執行情形報告	無異議
114/8/13	內部稽核主管就114年Q2稽核業務執行情形報告	無異議
114/11/12	內部稽核主管就 114 年 Q3 稽核業務執行情形報告 內部稽核主管就 115 年稽核計畫討論及溝通	無異議 無異議

內部稽核主管每月透過稽核報告與獨立董事溝通；透過審計委員會議，每季至少一次報告稽核業務執行狀況，並不定期將專案查核結果報告說明寄送獨立董事查閱並進行討論溝通。本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

2. 獨立董事與會計師溝通事項:

日期	溝通重點	獨立董事意見
114/2/26	會計師就 113 年度合併財務報告(含個體財務報告)查核結果說明，並與獨立董事進行討論	無異議
114/5/7	會計師就 114 年第一季合併財務報告查核結果說明，並與獨立董事進行討論	無異議
114/8/13	會計師就114年第二季合併財務報告查核結果說明，並與獨立董事進行討論	無異議
114/11/12	會計師就 114 年第三季合併財務報告查核結果說明，並與獨立董事進行討論	無異議

本公司簽證會計師與獨立董事溝通事項，包括就當季財務報告查核或核閱結果以及重大發現、法令修訂對公司之影響等情形。截至年報刊印日止，本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司為建立良好之公司治理制度，並符合「上市上櫃公司治理實務守則」相關精神，已訂定「公司治理實務守則」並揭露於公司網站。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 本公司為確保股東權益，設有公司專屬網站，並設置投資人專區，充分揭露公司營運與治理相關訊息，並依法規定於公開資訊測站及時公告營運資訊與重大訊息、召開股東常會與臨時會，使股東能充分知悉、參與及決定重大事項，設有發言人、代理發言人、股務部門及委託專業股務代理，處理股東建議或糾紛等相關問題。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 本公司設有股務人員及並定期由股務代理機構(元大證券股務代理部)更新股東名冊並掌握公司主要股東及其控制者之名單。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三) 本公司與關係企業之財務及業務均獨立運作，並建立內部控制制度等相關管理制度，遵循「關係人交易管理辦法」、「對子公司監督管理辦法」以建立完整防火牆並達風險控管機制。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司已訂定「防範內線交易管理辦法」，避免及防止獲悉消息範圍者因未諳法規誤觸內線交易。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 本公司於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策，依政策訂定具體管理目標並落實執行，請參閱本年報「董事會多元化及獨立性」(第10頁)。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責，未來將視公司營運情形及相關法令增設其他功能性委員會。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評	✓		(三) 本公司已於 108/8/13 訂定董事會績效評估辦法，並每年定期進行績效內部評估，及至少每三年外部評估，績效評估結果將運用於個別董事薪資報酬及提

估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			名續任之參考。 114年董事會內部績效評估結果已於115/2/25向董事會報告。 (四)本公司審計委員會每年定期評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」外，並依(註1)標準評估，確認簽證會計師符合獨立性及適任性。 本公司取得會計師所提供之專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力五大面向之13項審計品質指標(AQIs)資訊，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質與同業平均水準相當。最近一年度評估結果業經115年2月25日審計委員會討論通過後，並提報115年2月25日董事會決議通過。	無差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東之會議相關事宜、製作董事會及股東會議紀錄等)？	✓		本公司經112/2/22董事會任命財務處-蔡嘉農副處長兼任本公司公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，除辦理董事會及股東之會議相關事宜、製作董事會及股東會議紀錄外，亦負責處理董事要求事項、協助董事就任及持續進修，協助董事遵循法令，辦理董事異動相關事宜，以及向董事會報告就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合法令規定等。 114年公司治理主管已完成12小時進修時數，符合持續進修之規定，進修情形請參閱(註4)。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人溝通管道(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司網站設有利害關係人聯絡資訊，與利害關係人(包括股東、員工、客戶、供應商及其他利害關係人)保持良好的溝通管道，本公司秉持誠信原則，提供充足之經營資訊，適當維護利害關係人之合法權益。 相關具體說明，請參閱(註2)利害關係人溝通管道。	無差異
六、公司是否委任專業股務機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務機構元大證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜。	無差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓ ✓		(一)本公司設有企業網站，網址為 https://www.winwayglobal.com/ ，並透過公開資訊觀測站查詢各項資訊，即時揭露財務業務與公司治理相關訊息。 (二)本公司已建立英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、並將法人說明會之簡報資料及相關訊息放置於公司網站。	無差異

(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		(三)本公司於會計年度終了兩個月內公告申報年度財務報告，及於規定期限內公告申報第一、二、三季財務報告及各月份營運情形。									
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓		(一)員工權益與僱員關係： 本公司一向保障同仁權益，除法定保障外，另有良好福利措施及暢通之互動管道與多元申訴管道。 (二)投資者關係： 透過公開資訊觀測站及公司網站充分揭露資訊讓投資人瞭解公司營運狀況，並透過股東會及發言人與投資者溝通。 (三)供應商關係:本公司與供應商溝通管道暢通，維持良好之合作關係。 (四)利害關係人之權利： 本公司秉持誠信、道德等公司治理的精神，與股東、政府單位、客戶、員工及供應商等利害關係人溝通順暢，關係良好。(利害關係人溝通管道請詳註2) (五)董事進修之情形：(114 年度董事進修之情形請詳註 3) (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司依法訂定各種內部規章經董事會或股東會通過，並進行各種風險管理及評估。 (七)客戶政策之執行情形： 本公司致力品質改善及專業技術之提升，提供予客戶最好的服務及產品。 (八)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司為董事投保責任險情形如下： <table><tr><td>投保對象</td><td>保險公司</td><td>投保金額</td><td>投保期間</td></tr><tr><td>全體董事</td><td>國泰世紀產物保險股份有限公司</td><td>200,000,000</td><td>114/8/3~115/8/3</td></tr></table>	投保對象	保險公司	投保金額	投保期間	全體董事	國泰世紀產物保險股份有限公司	200,000,000	114/8/3~115/8/3	無差異
投保對象	保險公司	投保金額	投保期間									
全體董事	國泰世紀產物保險股份有限公司	200,000,000	114/8/3~115/8/3									
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)	✓		本公司 114 年針對公司治理評鑑指標已執行之改善計劃如下： 本公司已編制英文版永續報告書，並上傳至公開資訊觀測站。 未來持續依評鑑指標加強永續報告書之揭露。	不適用								

(註 1)

簽證會計師獨立性及適任性之評估

(1)依據職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」，評估情形如下：

獨立性		符合獨立性情形	
項次	說明	是	否
1	本公司委任之會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，是否應予迴避，不得承辦。	V	
2	財務報表之查核或核閱係提供廣泛潛在之報表使用者高度或中度但非絕對之確信，會計師除維持實質上之獨立性外，其形式上之獨立更顯重要。因此，審計服務小組成員、其他共同執業會計師、事務所及事務所關係企業是否對本公司維持獨立性。	V	
3	本公司委任之會計師是否保有下列事項： (1)正直：會計師應以正直嚴謹之態度，執行專業之服務。 (2)公正客觀：會計師於執行專業服務時，應維持公正客觀態度，同時應避免利益衝突而影響獨立性。 (3)獨立性：會計師於執行財務報表之查核式核閱時，應於形式上及實質上維持超然獨立立場，公正表示其意見。	V	
4	會計師的獨立性與正直、公正客觀相關聯，是否於委任時有缺乏或喪失獨立性，進而影響正直及公正客觀之立場。	V	
5	會計師的獨立性是否受到自我利益、自我評估、辯護、熟悉度及脅迫而有所影響。	V	
6	獨立性受自我利益之影響，係指經由本公司獲取財務利益，或因其他利害關係而與本公司發生利益上之衝突。是否未產生下列影響之情況： (1)與本公司有直接或重大間接財務利益關係。 (2)與本公司或其董監事間有融資或保證行為。 (3)考量本公司流失之可能性。 (4)與本公司有密切之商業關係。 (5)與本公司間有潛在之僱傭關係。 (6)與本公司所查案件有關之或有公費。	V	
7	獨立性受自我評估之影響，會計師執行非審計服務案件所出具之報告或所作之判斷，於執行財務資訊之查核或核閱過程中作為查核結論之重要依據；或審計服務小組成員曾擔任本公司之董監事，或擔任直接並有重大影響該審計案件之職務。是否未產生下列影響之情況： (1)審計服務小組成員目前或最近兩年內擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 (2)對本公司所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目	V	
8	獨立性受辯護之影響，係指審計服務小組成員成為本公司立場或意見之辯護者，導致其客觀性受到質疑。是否未產生下列影響之情況： (1)宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。 (2)擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。	V	
9	熟悉度對獨立性之影響，係指藉由與本公司董監事、經理人之密切關係，使得會計師或審計服務小組成員過度關注或同情本公司之利益。是否未產生下列影響之情況： (1)與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。 (2)卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 (3)收受本公司或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。	V	

獨立性		符合獨立性情形	
項次	說明	是	否
10	脅迫對獨立性之影響，係指審計服務小組成員承受或感受到來自本公司之恫嚇，使其無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。是否未產生下列影響之情況： (1)要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。 (2)為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。	V	
11	事務所及審計服務小組成員有責任維護獨立性，維持獨立性時應考量所執行之工作內容對獨立性是否有影響，並可消除前述影響或使其降低至可接受程度之措施。	V	
12	當確認對獨立性之影響為重大時，本公司、事務所及審計服務小組成員是否有採用適當的措施，以消弭該項影響或將其降低至可接受之程度，並紀錄該項結論。	V	
13	本公司、事務所及審計服務小組成員如未採取任何措施或所採用之措施無法有效消弭對獨立性之影響或降低至可接受之程度，是否應該更換會計師，以維持其獨立性。	V	

(2)適任性之評估：

適任性		符合適任性情形	
項次	說明	是	否
1	是否具會計師資格，得以執行會計師業務。	V	
2	是否無受主管機關及會計師公會懲戒之情事、或依證券交易法第37條第3項規定所為之處分。	V	
3	是否對本公司具有相關產業之知識。	V	
4	是否依一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則執行財務報表查核工作。	V	
5	是否無利用會計師地位，在工商上為不正當之競爭。	V	

(註 2)

利害關係人溝通管道

利害關係人類型	主要關切議題	溝通方式 (頻率)	利害關係人溝通實績
員工	-員工及薪資福利 -人才吸引與留任 -人才發展	- 公司內部佈告欄和共用資料夾(常設) - 內部員工訴願管道(常設) - 性騷擾檢舉信箱(常設) - 教育訓練(不定期) - 員工座談會(每半年) - 員工關懷訪談(不定期) - 勞資會議(每季) - 職工福利委員會(不定期) - 績效面談和考核(每半年)	- 召開福委會會議 4 次 - 舉辦總經理溝通會 2 次 - 舉辦公司內部教育訓練 900 場次 - 每半年公司全員績效考核與面談 - 舉行 4 次定期勞資會議。
供應商	-誠信經營 -法規遵循 -產品品質與安全 -資訊隱私與安全 -創新研發	- 採購程序(依需求執行) - 供應商評核(定期) - 供應商稽核(不定期) - 供應商拜訪 or 電話會議(不定期) - 各單位檢討會議(依產品類別辦理) - 採購會議(定期) - 供應商信箱: supplier@winwayglobal.com	- 供應商評核(1 次/季) - 採購人員稽核(不定期) - 供應商拜訪-主要原料(1 次/月)
客戶	-供應商管理 -產品品質與安全 -資訊隱私與安全	- 面對面、電話與電子郵件方式進行拜訪或討論。 - 實體會議或虛擬線上會議。 - 向客戶發出產品發表會議或由客戶端舉行的供應商會議。 - 客訴信箱: sales@winwayglobal.com ，或向業務窗口之主管或以上等級透過面對面訪談、電話或電子郵件方式投訴。 - 陌生客戶接洽信箱： sales@winwayglobal.com 。 - 藉由大型展覽活動參展加強公司品牌形象，增加多元與客戶互動管道。 - 報章雜誌媒體文章報導。 - 產品售後服務信箱： support@winwayglobal.com	- 利用實體或線上會議討論技術、交期、新產品開發等相關議題，實際執行對象共 6~10 間客戶。 - 重點專案不定期與客戶開會更新技術開發進度，實際執行專案共 40~80 件。 - sales@winwayglobal.com 平均一天收到 15~20 封信，內容除與客戶、業務相關外，另有媒體採訪、廣告推廣等；客戶業務相關皆在 24 小時內指派對應窗口並回覆。 - support@winwayglobal.com 提供給客戶作為技術諮詢聯絡窗口，平均一天收到 6~10 封信，皆在 12 小時內回覆客戶。 - 大型展覽活動: SEMICON China 已如期於 2025/3/26~3/28 舉辦完畢，SEMICON SEA 已於 2025/5/20~5/22 已於新加坡舉辦完畢，SEMICON Taiwan 已於 2025/9/10~9/12 於台北舉辦完畢。

資金提供者	-誠信經營 -多元與包容 -職業安全	-電話和電子郵件(常設) -發言人/代理發言人(常設) -法人說明會(不定期) -公司網站及公開資訊觀測站(常設) -股東常會(每年) -投資人信箱(investor@winwayglobal.com)	-公開資訊觀測站公告重大訊息 57 則 -舉行 1 次股東常會 -受邀參加法說會 11 場
政府主管機關	-法規遵循 -溫室氣體排放 -能源管理	-公文往來(不定期) -拜訪和會議(不定期) -宣導說明會(不定期) -座談會(不定期) -環安衛申報(每月) -配合主管機關監理與查核(不定期)	-向主管機關申報事項皆如期完成。 -未有違反環保法規而受裁罰之情形。
非營利公益組織	-員工及薪資福利 -法規遵循 -多元與包容 -溫室氣體排放 -社會公益	-公司網站(常設) -宣導說明會、座談會、論壇、研討會(不定期) -課程與參訪(不定期) -透過公司成立的高雄市穎歲慈善關懷協會進行公益活動和捐贈	-發起同仁參與丹娜絲颱風賑災捐款活動。 -發起同仁參與花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情募款活動。 -贊助國立岡山高中機器人競賽校隊參加 2025 FRC 世界機器人競賽國際比賽經費。 -透過財團法人普仁青年關懷基金會與社團法人高雄市慈善團體聯合總會，對高雄清寒學子提供就學補助，嘉惠 15 位同學。 -透過社團法人高雄市螢火蟲兒少福利服務關懷協會，捐助端午/中秋等節慶愛心禮盒、年節便當/暑假營養午餐、暑假成長營、民生物資等。 -參與港都科技三三會、順發公益運動協會、順發電腦、匠愛家園等團體舉辦之公益路跑活動，並全額補助同仁及眷屬報名費，共 135 位。 -與財團法人天主教善牧社會福利基金會合作，發起同仁達成弱勢兒少聖誕心願傳遞溫暖與愛心，共送出 100 份聖誕禮物。以及捐助弱勢兒童開學文具禮券。 -與希恩之家合作，捐助失依兒童健康復建計畫、營養照顧與設備更新計畫以及參與志工陪伴計畫。 -贊助台東縣政府與新古典室內樂團主辦之“藝起傳愛，光照偏鄉”活動。 -與心路基金會合作，藉由採買禮盒，以實際行動鼓勵身心障

				礙者，共購買 150 盒禮盒。 - 動員同仁與眷屬於高雄茄萣濕地種植 156 棵樹苗。 - 募集同仁發票捐助創世基金會，並贊助 2025 鄰聚有愛・ESG 公益園遊會。
學術單位	-人才吸引與留任 -廢棄物管理 -能源管理	- 公司網站(常設) - 宣導說明會、座談會、論壇、研討會 (不定期) - 課程與參訪(不定期) - 公會/協會舉行的技術研討會	- 與高雄各知名大學合作校園博覽會，提供學子從校園轉入職場的管道與協助。 - 為培育封測電子產業專才，偕同中山大學成立半導體及重點科技研究學院，培育國家重點產業人才，提供百萬獎學金。目前已有第三屆學生進入穎威實習，實習結束銜接就業，紮實培育人才專業能力。	

(註3) 114 年度董事進修之情形

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	企業併購策略與規劃	3
	114/11/17	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3
	114/07/31	臺灣證券交易所	114 年度壯大臺灣資本市場高峰會	3
董事	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	企業併購策略與規劃	3
	114/11/17	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3
董事	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	企業併購策略與規劃	3
	114/11/17	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3
董事	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	企業併購策略與規劃	3
	114/11/17	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3
董事	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	企業併購策略與規劃	3
	114/11/17	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3
董事	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	企業併購策略與規劃	3
	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3
董事	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	企業併購策略與規劃	3
	114/11/17	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3
董事	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	企業併購策略與規劃	3
	114/11/17	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3
董事	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	企業併購策略與規劃	3
	114/03/25	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	114/03/25	社團法人中華公司治理協會	公司治理下之經營權競爭行為規範與實務案例解析	3

(註4) 114 年度公司治理主管進修之情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理主管	蔡嘉農	114/04/18	台灣投資人關係協會	公司治理升級:打造人才競爭力新局 國際產業人才趨勢與因應策略	3
		114/08/28~114/08/29	社團法人中華公司治理協會	溫室氣體管理實作工作坊暨永續發展宣導會- 高雄場	9

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形。

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形（註2）	兼任其他公開發行人薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	洪秀一	請參閱第9頁至第10頁-董事專業資格及符合獨立性情形		0
獨立董事	李聰結			2
獨立董事	王文信 (註)			0
獨立董事	張晉誠			2

(註)王文信董事於 114.11.24 辭任

2. 薪資報酬委員會之職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

(1)定期檢討本規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

(3)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3. 薪資報酬委員會運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期: 112 年 07 月 03 日至 115 年 06 月 20 日，114 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下:

職稱	姓名	實際出 (列)席次 數(B)	委託出席 次數	實際出 (列)席率 (B)/(A)	備註
召集人	洪秀一	4	0	100%	王文信董事於 114.11.24 辭任
委員	李聰結	4	0	100%	
委員	王文信	3	0	100%	
委員	張晉誠	4	0	100%	
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。					

4. 114 年度薪資報酬委員會之討論事由與議決結果及公司對於成員意見之處理：
第三屆第七次薪資報酬委員會(114 年 2 月 26 日)

議案內容	決議情形	公司對薪酬委員會意見之處理
本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	全體出席委員照案通過	董事會全體出席董事同意通過
本公司經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構檢討案	全體出席委員照案通過	董事會全體出席董事同意通過

第三屆第八次薪資報酬委員會(114年8月13日)

議案內容	決議情形	公司對薪酬委員會意見之處理
本公司 113 年度董事酬勞分派案	全體出席委員照案通過	除利益迴避之董事外，董事會其餘出席董事同意通過
本公司 113 年度經理人員工酬勞分派案	全體出席委員照案通過	除利益迴避之董事外，董事會其餘出席董事同意通過
審議本公司發行 114 年限制員工權利新股經理人獲配名冊、數量等相關事宜案	全體出席委員照案通過	董事會全體出席董事同意通過

第三屆第九次薪資報酬委員會(114年11月12日)

議案內容	決議情形	公司對薪酬委員會意見之處理
本公司經理人薪酬定期檢討案	全體出席委員照案通過	董事會全體出席董事同意通過

第三屆第十次薪資報酬委員會(114年12月10日)

議案內容	決議情形	公司對薪酬委員會意見之處理
本公司獨立董事報酬調整案	本案討論及決議時採逐一個別迴避，經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過。	董事會全體出席董事同意通過

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
推動項目	是	否	
損要說明			
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司於111年成立「永續發展小組」，由總經理擔任主席，帶領包含財務處、人資部、職安部、製造處及全球業務行銷處之高階主管，以功能職責分為六個工作小組:「公司治理小組」、「員工照顧小組」、「社會關懷小組」、「環境永續小組」、「供應鏈/產品管理小組」、「品牌經營小組」，共同訂定永續發展相關政策、制度或管理方針及具體推動計畫之規畫，並定期將年度永續發展推動執行成果及利害關係人溝通成果等(每年至少一次)提報董事會。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		1. 本揭露資料涵蓋本公司114年1月至114年12月間在臺灣地區所有廠區之永續發展績效表現。 2. 本公司依重大性原則評估具重大性之ESG議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。
			</

[illegible]

[illegible]

							續發展趨勢，運用先進的半導體設計及生產技術，開發創新的產品與服務以強化核心競爭能力，即時回應環境變動及市場趨勢，持續的創新突破，為本公司創造經濟價值。		
						資訊隱私與安全	內部資訊、客戶機密外洩將影響公司營運，未能保全客戶隱私與秘密資訊也將造成公司遭受求償衍生的財務或聲譽損失。 1. 本公司重視客戶隱私，嚴格確保客戶相關資訊之保護。本公司與客戶往來之文件、資料等商業資訊，均透過公司內部系統嚴格控管，提供全面且安心的服務。		
二、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓					本公司遵循環保法規及相關之國際標準則規範，善盡環境保護責任，致力於環境永續發展。 本公司於 103 年導入 ISO 14001 環境管理系統，106 年完成 ISO 14001：2015 改版驗證(證書有效期自 2024/9/4~2026/7/24)。依產業特質訂定公司環境政策，持續推行改善環境管理方案，每年並透過內外稽核制度確保系統之有效運作。	無差異		
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓					1. 本公司以生命週期為考量，透過產品環境化設計、製程減廢、(RoHS)危害性物質禁用、化學原物料管理、廢棄物分類管理、R.O.廢水再利用、節電管理等管控制措施，降低各項產品、服務及活動之環境衝擊。 2. 在綠色製造上，生產使用之主要原物料，均符合 RoHS、REACH 等國際環境規範，並致力於減少消耗自然資源，及尋求廢棄物減量、再利用之技術開發；選用環保包材，並採取減量、回收再使用等行動方案。	無差異		
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓					1. 氣候變遷相關議題為本公司關注之環境議題之一，每年均定期審視評估其潛在風險與機會，並致力推動相關節能省水方案。 2. 公司積極導入電子作業平台，減少紙張列印使用，朝無紙化目標邁進，期望達到環境永續的低碳環保企業。	無差異		
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓					本公司所有台灣廠區已完成 114 年度 ISO 14064-1 溫室氣體盤查查驗，並取得第三方外部查驗聲明書。 最近 2 年溫室氣體排放量： 113 年及 114 年統計範疇涵蓋高雄一廠、高雄二廠、新竹廠及新竹辦公室。	無差異		

具體方案	
提供安全、健康、衛生之工作環境	流感疫苗施打、員工健檢、癌症篩檢、團體由營養師計算熱量，另有健康促進活動，如：減重、戒菸、高血壓、緊急救護、CPR 及 AED 等課程。公司設有 AED、氧氣瓶、急救箱，每半年環境監測。由專責護理師及醫師臨場服務提供健康諮詢及護理衛教指導追蹤，並執行四大計畫。
員工可依法自由結社、組織社團	員工可自由成立社團，訂有「社團成立辦法」；並依照法令由勞資雙方代表組成勞資會議，定期召開。
禁止雇用童工、禁止強迫勞動	本公司並無進用童工，並訂有「工作規則」、「招募任用管理辦法」、「考勤管理辦法」等，並嚴格落實。
支持並致力使員工身心健康及工作生活平衡	公司有提供哺乳室、健身房、韻律教室及康樂設施，提供當季流行疾病衛教資訊。並定期舉辦員工旅遊、家庭日及運動日等戶外活動，以補助方式鼓勵員工參與。
杜絕各種歧視、霸凌與騷擾，且提供內外部溝通及違規舉報的多元管道	公司訂有「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」，114 年度列入員工年度教育訓練及新人訓練中，亦有職場不法侵害防治與申訴管道之教育訓練，114 年度完成 767 人次之訓練。
隱私及個資保障	公司導入 ISMS，對資訊安全及個資進行控管及保障。
制定「供應商行為準則」，將人權相關規範傳達給供應商	在供應商評估與評核階段時，便會請供應商進行簽署「供應商行為準則」。

(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓	1. 本公司提供良好的勞動條件，滿足員工需求，除依法提供基本保障外，透過職工福利委員會，辦理各項職工福利活動及補助。訂有相關薪酬、各項獎金及考核辦法，將工作績效與個人的薪酬作有效連結。 2. 為吸引及留住優秀人才，使員工與公司共享營運成果，本公司提供具有競爭力的薪資與獎勵以吸引及留住優秀人才，提供合理且具競爭力的薪酬制度。 (1) 具競爭力的激勵報酬 ◆ 正式員工三節獎金兩個月 ◆ 依工作表現給予合理的年度績效調薪，114 年全集團進行年度及晉升調薪，平均調薪幅度為 5~10%，個人最高達 20%。 ◆ 依公司營運獲利成果、部門工作目標及個人考績享有績效獎金及年度分紅。 ◆ 員工享有免費團體保險，涵蓋本人壽險、本人意外傷害險、團體傷害醫療險、住院醫療險、癌症醫療險、海外急難求助及更約權等。更注重新於因員工發生意外事故，所致的身故、失能、醫療及燒燙傷等方面的保障，同時包含員工不能工作期間的薪資、醫療傷病給付。 ◆ 限制員工權利新股：公司發行限制員工權利新股，以留住專業人才，並激勵員工長期服務、對公司的向心力，以共同達成公司營運目標 ◆ 員工持股信託：開放員工額外以全薪水 20% 為提撥上限，公司依員工自提金及績效表現給予相對應之公提金，作為員工長期財務規劃的一環 (2) 身心平衡活動 ◆ 定期舉辦年終聯誼餐會 ◆ 國內員工旅遊，且享有年度旅遊補助 ◆ 每季部門聚餐及不定期社團活動 ◆ 總公司設置撞球室/桌球室/健身房/哺乳室/休息室 (3) 幸福彈性假期 ◆ 週休二日/彈性上下班制度 ◆ 產檢假、產假、陪產假、育嬰留職停薪、育嬰工時、家庭照顧假、女性同仁生理假等	無差異
---	----------	---	------------

			(4)貼心同仁協助 提供結婚、生育賀禮、住院慰問金、住院慰問禮品、喪葬慰問金及急難救助金等。 (5)職工福利委員會： 本公司已依職工福利金條例成立職工福利委員會，統籌各項職工福利。每年度編製預算及福利規劃，除對員工之婚、喪、病及生育予以各項補助外，尚有生日及年節禮金，並定期辦理各項旅遊活動，以調劑員工身心並加強員工間之聯誼。 (6)生活關懷 彈性上下班制度，員工可自行調配工作時間。		
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓	職業安全衛生政策及管理 本公司遵守之職業安全衛生法規要求，依循國際標準化組織(ISO)之「職業安全衛生管理系統(ISO 45001:2018)」條文及架構，制定職業安全衛生政策蒐集內外部議題、利害關係人的需求與期望，並在最高管理階層的領導支持及工作者諮詢、參與下，進行安全衛生危害鑑別與風險評估，訂定、執行職安衛目標及績效指標，透過自動化機械防護裝置、化學品管理、危害警示標示及配發防護器材等措施致力消除危害和降低職安衛風險；透過每年定期安全衛生教育訓練培養員工安衛意識，實施緊急救護、CPR及AED等課程及推動健康促進活動，並定期辦理員工健康檢查，由專業醫護人員，提供健康諮詢與指導，以營造安全及健康之職場環境。 管理系統驗證範圍 本公司高雄廠區已於2019年通過ISO 45001職業安全衛生管理系統國際標準驗證(最新證書有效期自2025/12/31~2028/12/25)，並透過定期內外部稽核制度確保系統之有效運作。 作業環境監測 透過執行規劃、採樣、監測及分析，掌握員工工作場所作業環境與評估工作者其作業環境暴露狀況，定期每年執行2次作業環境監測，均確認作業場所危害物質濃度均低於容許暴露標準，以保障現場工作者安全。	無差異		

			職安查核 •職安衛現場巡視管理 各單位主管定期或不定期每週進行至責任區安全衛生巡視，針對有不安全行為人員實施安全指導。 職安部門除提供各單位安全衛生諮詢及輔導外，並每週不定期至作業現場進行安全衛生之巡視，如巡檢有發現異常，即通知缺失單位執行缺失矯正及預防改善措施。 •承攬商施工巡檢 承攬商進入各廠區，由本公司工程需求單位進行作業危害因素告知，遵守作業相關之安全衛生規定。施工中則透過工程需求單位及職安部門進行不定期安全巡查，藉輔導與稽查方式並行，共同防止職業災害之發生，守護職場安全。 職安績效 •公司近二年-員工失能傷害統計 <table><thead><tr><th>年度</th><th>事故類型</th><th>死亡事故</th><th>失能事故</th></tr></thead><tbody><tr><td>113</td><td></td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>114</td><td></td><td>0</td><td>5</td></tr></tbody></table> 說明:上述統計事件僅限於廠內執行公務範圍，不含上下班通勤交通事故。 本公司 113~114 年度無發生火災事件。	年度	事故類型	死亡事故	失能事故	113		0	1	114		0	5	無差異
年度	事故類型	死亡事故	失能事故													
113		0	1													
114		0	5													
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	穎威科技落實人才培育與職能發展，114年再次獲得TTQS企業機構版銅牌肯定，培訓訓練目的是讓員工對於公司營運策略及組織概況有所了解，並增進工作上所需具備之專業知識、技術能力外，也能讓員工與公司擁有一致目標，為公司創造最大價值及利潤。 穎威科技注重公司同仁的訓練發展與職務學習，規劃完整的學習架構：新人基礎及通識訓練、部門專業職能訓練、跨部門訓練及晉升管理訓練，建構完整的職涯發展訓練課程以提升整體員工素質、技術及加強組織對環境應變之能力，增加公司競爭力，以達成公司所訂之營運策略與目標。 每年盤點員工職能需求與落差，規劃各階段相應的訓練課程，開展出各職務的培訓路徑，確保訓練內容能有效應用並符合各階段的工作實務中，以多元														

			課程設計：包含管理類、專業類、產品核心類、語文及軟性類等，並且針對不同層級設計專屬課程。114年度舉辦公司內部教育訓練課程共900場次，人均受訓時數為19.38小時。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司研發中心建置之實驗室與認證單位合作以符合國際能效規範，以確保產品能合法地在全球各地區銷售且滿足客戶及市場節能產品規範。公司訂有客訴處理程序，對產品與服務提供透明且有效之溝通管道，並於公司網站設置企業社會責任專區，內含利害關係人溝通管道之建置，以利客戶申訴及各利害關係人之意見表達；且每年定期實施客戶滿意度調查，就調查結果與以分析及改善。	無差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司訂有「類廠供應商管理要點」，建立供應商保護環境、人權、安全、健康且永續性發展之篩選條件，及對供應商在環安衛風險、禁用童工、勞工管理、無危害勞工基本權利、道德準則及誠信經營等面向的要求及期待。本公司成立供應商輔導專案，透過選商、稽核輔導、績效評估、訓練與供應商論壇，以合作為基礎，將永續的要求貫徹於供應鏈日常管理之中，本公司目前合作供應商 100%符合以下條件。 供應商評估： 1. 所有供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。 2. 製程相關原物料供應商必須通過ISO9001 品質管理系統認證。 3. 廠務及相關作業承攬商必須取得 ISO45001 職業安全衛生管理系統認證。 4. 供應商依業務類別取得政府核發之有效工廠登記證及 ISO14001 環境管理認證。 供應商稽核： 本公司成立稽核小組及輔導團隊，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、強化環保安全衛生績效並導入自動化提升產能。	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司已參照全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 所出版之GRI準則撰寫，並依循GRI準則之核心選項編製永續報告書，尚未取得第三方驗證單位之確信。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定永續發展實務守則，運作情形無重大差異。				

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：

(一)環保：遵循環保法令，執行管控，並推行 ISO14001 環境管理系統，持續改善。

本公司 114 年投資以下節能設備以達節能減碳效益：

	設備名稱	金額	可節能(或節碳)
1	燈具汰換為 LED 燈	124 仟元	66.56GJ
2	資訊機房分離式冷氣汰換	90 仟元	30.61GJ
3	空調調升冰水出水水溫 1.5°C	0 元	76.38GJ

(二)社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益：

公益主軸	合作對象	合作內容
兒少/弱勢家庭	社團法人高雄市螢火蟲兒少福利服務關懷協會	針對高雄在地弱勢清寒家庭，在年節/端午/暑假時給予愛心便當，贊助舉辦暑期成長營等。
清寒教育	財團法人普仁青年關懷基金會	針對高雄清寒學子提供就學補助，捐贈共 5 位同學。
清寒教育	社團法人高雄市慈善團體聯合總會	針對高雄清寒學子提供就學補助，捐贈共 10 位同學。
STEAM 教育	國立岡山高中	贊助岡山高中機器人競賽校隊參加 2025 FRC 世界機器人競賽國際比賽經費。
公益路跑	港都科技三三會、順發公益運動協會、順發電腦	全額補助同仁及眷屬參與 2025 RUN FOR FUTURE 第四屆順發 x 港都公益路跑，共 33 位。
公益路跑	匠愛家園	全額補助同仁及眷屬參與 2025 第十屆匠愛家園公益路跑，共 102 位。
兒少/弱勢	財團法人高雄市私立希恩之家	捐助失依兒童健康復健計畫、營養照顧與設備更新計畫以及參與志工陪伴計畫。
偏鄉弱勢/藝文	台東縣政府、新古典室內樂團	贊助台東縣政府與新古典室內樂團主辦之“藝起傳愛，光照偏鄉”活動。

人道	財團法人賑災基金會	發起同仁參與丹娜絲颱風賑災捐款活動。
兒少/弱勢家庭	財團法人天主教善牧社會福利基金會	捐助弱勢兒童開學文具禮券；透過達成聖誕心願傳遞溫暖與愛心，共送出100份聖誕禮物。
身心障礙	財團法人心路社會福利基金會	藉由採買禮盒，以實際行動鼓勵身心障礙者，共購買150盒禮盒。
環境保育	社團法人高雄市愛種樹協會	動員同仁與眷屬於高雄茄萣濕地種植156棵樹苗。
植物人	財團法人創世社會福利基金會	募集同仁發票捐助創世基金會；贊助2025鄰聚有愛·ESG公益園遊會。
人道	臺灣基督教門諾會醫療財團法人	發起同仁參與花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情募款活動，將善款捐予門諾團隊，進行急診、傷口處理、慢性病照護與藥物補給，並協助災後重建。

(三)消費者權益：本公司設有專人處理客訴案件，服務客戶。

(四)人權：招募員工以平等僱用為原則，並遵循勞基法及相關法令規定，以保障人權及員工應有權益。保障員工就業權益不受侵犯，禁止任何對族群、膚色、年齡、性別、性傾向、民族、懷孕、信仰、政治派別、社團成員或婚姻狀況等歧視行為，以保證人人平等、公正對待。禁止任何形式的就業歧視。

(五)職場多元化：重視員工，從選、用、育、留等環節都秉持提供員工工具尊嚴、公平及安全的工作環境，保障員工職場權益不受侵犯，禁止任何對族群、膚色、年齡、性別、性傾向、民族、懷孕、信仰、政治派別、社團成員、婚姻狀況及其他受適用法規保護的任何其他狀況，禁止任何形式的歧視，落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會公平性之政策，以保證人人平等、公正對待。

指標	百分比
女性佔總員工(%)	45%
女性佔所有主管(%)	28%
女性佔高階主管(%)	8%

(六)安全衛生：遵循安全法令，執行管控，並推行ISO45001職業安全衛生管理系統，持續改善。

1.健康職場風險管控：透過風險評估分析，對潛在危害因子進行風險控制，預防職業相關疾病發生。

2.促進健康職場：辦理健康檢查、疫苗接種、健康講座及活動、推動職場菸害防制等，提供同仁健康職場。

3.112年以優異的成果取得「健康微行動，職場心計畫」之健康促進獎狀；113年通過衛生福利部國民健康署健康職場認證，取得健康職場促進標準。

八、氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形					
	類別	項目	影響時點	業務及策略影響	財務影響	
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	轉型風險	政策法規要求	中期	本公司須考量因應政策法規要求設定再生能源或溫室氣體減量目標，進而影響公司所有廠區之能源管理系統的設計，除須確保能源供應無虞外，尚需評估導入再生能源...等，否則本公司將面臨更高的能源使用成本、碳費或罰鍰。	營業成本增加 營業費用增加	
	實體風險	長期平均氣溫上升及極端氣候下的旱災或水災	中期	因溫室效應所引發的極端氣候事件，本公司除須評估未來實體資產的安全性外，尚須建立當遭遇異常天氣事件時，公司是否具有備援措施，如水資源、能源的不間斷供應以維持正常營運，這些措施需要本公司進行廠房或產線整改。此外，在氣溫持續上升的情形下，如何維持產線溫度適宜，可能會衍生產線設備的汰換。	資本支出增加 營業成本增加	
	機會	建設節能建築	長期	在全球及台灣法規針對能源消耗的嚴加關注下，本公司未來進行廠房擴建或新設時，須建築物的能耗納入考量，藉此降低本公司的溫室氣體排放量而減少外部碳成本。	資本支出增加 營業成本減少 營業費用減少	

3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件可能導致供應鏈供貨中斷、員工交通受阻及因長期升溫所導致的員工生產效率低下，這些情況將導致本公司須承擔更高的維運成本及投資於防洪及防災設施、第二供應商機制建立……等措施進而影響本公司之財務規劃。 轉型行動則因為本公司投入於低碳產品之開發或因應法規及客戶需求變化而建置再生能源設備或更新產線設備。雖然轉型行動初期可能因為大量資本支出而導致面臨經營績效不佳的潛在風險，惟若本公司之轉型行動成功將可帶來長期性質的獲利並達成企業永續經營的目標。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司永續發展小組不定期蒐集國內外氣候變遷趨勢及法規變動，召開小組進行年度風險識別，並依據氣候風險及機會之鑑別結果研擬因應方案。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司尚未導入情境分析執行氣候變遷風險之韌性評估。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司因應管理氣候相關風險之轉型計畫尚待研議。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使	因經本公司評估，本公司非屬排碳大戶，氣候相關目標尚待研議。

用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。				
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	請參閱 1-2 及 1-2 填報內容。			
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形				
1-1-1 溫室氣體盤查資訊				
最近二年度溫室氣體排放量如下表，113 年尚未做第三方查證，114 年已完成溫室氣體確信。				
年 度	範疇一 (tonCO ₂ e)	範疇二 (tonCO ₂ e)	排放強度分母 (單位：百萬元)	排放強度(不納入範疇三) (tonCO ₂ e/當年度營收 (百萬元))
113	414.8232	5850.6086	5798	1.081
114	413.4407	6226.0070	7857	0.845
1-1-2 溫室氣體確信資訊				
本公司 114 年度之溫室氣體排放量已委託第三方查驗機構 (SGS) 依據 ISO 14064-1:2018 準則辦理查驗，並已取得合理確信等級之查驗聲明書。				
1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。				
以範疇一及範疇二溫室氣體減量為目標(以 2024 年為基準年)				
- 短期目標(2028)：每年較基準年較少 1% - 中長期目標(2030)：每年較基準年較少 2%				

能源目標：

- 中長期目標(2030)：達成使用再生能源占該年度用電比率達 10%

減量策略：降低待機能源損耗、推動各項節能專案(汰換舊機、更換變頻、節能設備替換等)、環保材料研發及引進、設置綠電裝置。

具體行動計畫：

1. 提升照明設備使用效率，將 T5 燈具及平板 LED 效率不佳更換為 LED 燈具。
2. 提升空調設備使用效能，如：汰換效能不佳氣冷式冰水機、冰水主機調整冰水出水溫改善及辦公室區域溫度 25 °C 管控。
3. 提升空壓設備使用效能，如：汰換老舊定頻設備、設備零件更換及馬達保養
4. 完成各廠區 114 年度 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，並取得第三方外部查驗聲明書。
5. 建置太陽能發電設備，第一階段於高雄一廠裝設容量為 99.96kW，第二階段高雄二廠裝設容量為 259.125 kW。
6. 決議新建或擴建廠房全面取得綠建築標章。

減量達標情形：

1. 年度規劃內部稽核計畫，針對穎崙威須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程已符合規定。
2. ISO 14001 環境管理系統之導入，審查溫室氣體排放及能源管理績效。
3. 114 年燈具汰換及空調、空壓設備優化之節能方案，114 年總節電量達 646,026kWh，節能量約為 2326.22GJ。
4. 穎崙高雄一廠建置太陽能裝置容量 99.96kW，113 年度達 116,256 度發電量，114 年度達 116,284 度發電量。高雄二廠建置太陽能裝置容量 259.125Kw，113 年度達 335,608 度發電量，114 年度達 309,568 度發電量。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制訂經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層承諾積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓	✓	(一) 本公司「誠信經營守則」業經 108 年 12 月 12 日董事會核准訂定，另本公司「誠信經營作業程序及行為指南」亦經 110 年 3 月 19 日董事會核准修訂。 (二) 本公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南，詳述該如何防範不誠信行為及收受不正當利益之處理程序，透過定期宣導誠信經營政策，並將該政策與人力資源政策結合，設立明確有效之申訴及獎懲制度。 (三) 建立有效之會計制度及內部控制制度，禁止行賄及收賄、提供非法政治獻金、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益等行為，且並隨時檢討，俾確保該制度之設計與執行持續有效。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓	✓	(一) 於建立商業關係前，先行評估該往來對象之合法性、誠信經營政策，並與主要往來外部採購廠商簽訂之契約中明定誠信行為條款。 (二) 專責單位為總經理室，由其負責誠信經營作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並於 115 年 2 月 25 日第 9 屆第 17 次董事會議向董事會報告 114 年度執行情形，114 年各項誠信經營政策與防範方案推動執行成果如下： 1. 持續落實各項 ISO27001 資訊安全管理制度，妥善保護公司研發成果及營業秘密，提升公司競爭力。 2. 供應商承諾：全面要求主要供應商及新供應商導入時均須簽署廉潔承諾書及供應商行為準則承諾書，完成率達 100%。 3. 政策宣導與教育訓練： 以面授、線上訓練系統、公告等方式向全體員工進行誠信經營相關之政策宣導與教育訓練，議題包含商業道德、資訊安全、營業秘密、尊重智慧財產、法令遵循等課程，共計 1,100 人次參與，

(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為為方案之遵循情形，或委託執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓ ✓ ✓	完成率達100%，安排全體董事參與企業永續與ESG相關課程。 4. 檢舉制度與檢舉人保護：依公司治理要求加強資訊揭露，於公司網站公布誠信經營政策具體作法及其內外檢舉管道等資訊，落實公司檢舉制度，強化舞弊事件發生之偵防機制。 5. 定期檢核：對所有營運據點之營運活動，進行貪腐相關情事的風險評估，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作。 (三) 本公司在「誠信經營作業程序及行為指南」均有訂定明確規範及懲戒；另提供陳述及申訴檢舉管道，以落實守則之推動。 (四) 為落實誠信經營，本公司之會計制度及內部控制制度係依據證券發行人財務報告編製準則、公開發行公司建立內部控制制度處理準則等相關規定所制定，並由內部稽核人員定期查核會計制度及內部控制制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。 (五) 本公司定期舉辦誠信經營之教育訓練。	無差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立更便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓ ✓ ✓	(一) 本公司設有多元檢舉及申訴管道，如電子郵件、員工意見箱、檢舉專用信箱，另於公司網站公布誠信經營政策具體作法及其內外檢舉管道等資訊，以達有效及充分意見溝通之管道，使問題發生時，得以快速及有效溝通解決，強化舞弊事件發生之偵防機制。 (二) 有訂定申訴及舉報程序書，其中有調查標準作業程序及相關保密規定。 (三) 對任何檢舉案件均以密件方式建檔專案處理，並指派專責人員處理，明定保密機制，確保檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。	無差異
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓	公司業已制定誠信經營守則，並於公司網站揭露給投資人。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：無。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

穎崙科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115年2月25日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國112年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年2月25日董事會通過，出席董事8人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

穎崙科技股份有限公司



董事長兼總經理：王嘉煌



簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

開會日期	會議名稱	重要決議事項
114.02.26	董事會	- 通過本公司「113 年度內部控制制度聲明書」案 - 通過本公司 114 年度營運計畫及預算案 - 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 - 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 - 通過本公司 113 年度盈餘分配案 - 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行新股之增資基準日案 - 通過收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案 - 通過發行限制員工權利新股案 - 通過召開 114 年股東常會相關事宜案 - 通過本公司經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構檢討案 - 通過本公司擬捐贈「高雄市穎歲慈善關懷協會」案 - 通過授權董事張晉誠先生管理內部稽核單位案 - 通過本公司內部稽核主管異動案 - 通過配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師暨參考審計品質指標獨立性、適任性評估及委任報酬案
114.05.07	董事會	- 通過本公司 114 年第一季合併財務報告案 - 通過修正本公司「公司章程」案 - 通過解除董事競業禁止限制案 - 通過修正召開 114 年股東常會相關事宜案 - 通過取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產及供營業使用之不動產使用權資產額度案 - 通過處分營業用機器設備予磐時電子科技(蘇州)有限公司案 - 通過收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案 - 通過申請「花旗(台灣)銀行」借款額度到期展延案 - 通過申請「中國信託銀行」借款額度到期展延案
114.06.19	股東常會	- 承認 113 年度營業報告書及財務報表案 - 承認 113 年度盈餘分配案 執行情形:訂定114年7月13日為分配基準日，已依股東會決議於114年8月1日全數發放完畢(每股分配現金股利25元) - 通過修正本公司「公司章程」案 執行情形:向經濟部辦理公司變更登記，並經 114 年 7 月 3 日經園投輔字第 1140012911 號函核准 - 通過發行限制員工權利新股案 執行情形:經 114 年 7 月 29 日金管證發字第 1140351586 號函核准，並於 114 年 8 月 13 日發行 - 通過解除董事競業禁止限制案
114.08.13	董事會	通過本公司訂定「基層員工範圍」案

		2. 通過修正本公司「薪工循環」案 3. 通過本公司 114 年第二季合併財務報告案 4. 通過本公司 113 年度董事酬勞分派案 5. 通過本公司 113 年度經理人員工酬勞分派案 6. 通過修正 114 年度限制員工權利新股發行辦法案 7. 通過本公司發行 114 年限制員工權利新股案 8. 通過審議本公司發行 114 年限制員工權利新股獲配名冊、數量等相關事宜案 9. 通過收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案。 10. 通過取得子公司營業用機器設備追認案 11. 通過本公司 113 年永續報告書
114.10.30	董事會	1. 通過本公司擬採購 MEMS 探針產品案
114.11.12	董事會	1. 通過本公司 115 年度「稽核計畫」 2. 通過修正本公司「資訊作業循環」案 3. 通過修正本公司「財產管理辦法」案 4. 通過修正本公司「關係人交易管理辦法」案 5. 通過本公司 114 年第三季合併財務報告案 6. 通過收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案 7. 通過本公司董事、經理人薪酬定期檢討案 8. 通過本公司擬向金融機構申請信用額度案 9. 通過本公司修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則案
115.02.25	董事會	1. 通過本公司「114 年度內部控制制度聲明書」案 2. 通過本公司 115 年度營運計畫及預算案 3. 通過本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 4. 通過本公司 114 年度營業報告書及財務報表案 5. 通過本公司 114 年度盈餘分配案 6. 通過本公司擬以資本公積發放現金案 7. 通過修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案 8. 通過全面改選董事案 9. 通過召開 115 年股東常會相關事宜案 10. 通過仁武產業園區租地自建擴廠計畫案 11. 通過本公司經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構檢討案 12. 通過本公司策略長委任案 13. 通過本公司擬捐贈「高雄市穎歲慈善關懷協會」案 14. 通過本公司 115 年簽證會計師委任報酬暨參考審計品質指標獨立性、適任性評估案 15. 通過本公司擬向金融機構申請信用額度

(十) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、會計師公費資訊

(一) 簽證會計師資訊：

114 年度

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事	高鈺倫	114.01.01-114.12.31	2,100	561	2,661	非審計公費係稅務簽證、覆核非擔任主管員工薪資資訊、限制員工權利新股註銷資本額查核公費及覆核發行國內第二次無擔保轉換公司債案件等。
	曾國楊					
勤業眾信聯合會計師事務所	蔡育維	114.01.01-114.12.31	-	1,144	1,144	非審計公費係委託辦理移轉訂價報告及稅務諮詢公費。

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	114 年2 月26 日經董事會通過		
更換原因及說明	本公司自民國 114 年起會計師異動原因主要為配合會計師事務所內部職務調整所致。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情 況 \ 當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	無	會計原則或實務	
	無	財務報告之揭露	
	無	查核範圍或步驟	
	無	其 他	
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	安侯建業聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	高鈺倫會計師、曾國禔會計師
委 任 之 日 期	114 年2 月26 日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，於最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者

無此情形。

七、最近年度及截止至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及持股 10%以上大股東股權及質押變動情形

職稱	姓名	114 年度		115 年截至 3 月 31 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長 兼大股東	和威投資股份有限 公司 代表人：王嘉煌	-	500,000	-	-
總經理	王嘉煌	(25,000)	-	(10,000)	-
董事兼執 行副總經理	李振昆	-	-	(55,000)	-
董事兼執 行副總經理	陳紹焜	(59,000)	-	(13,000)	-
董事	劉燈桂	-	-	-	-
董事	CHIANG HOCK WOO	-	-	-	-
獨立董事	洪秀一	-	-	-	-
獨立董事	李聰結	-	-	-	-
獨立董事	王文信(註)	-	-	-	-
獨立董事	張晉誠	-	-	-	-
副總經理	謝東昇	(2,800)	-	(10,000)	-
副總經理	盧忻杰	5,000	-	(6,000)	-
副總經理	王文信(註)	-	-	-	-
資深協理	張漢政	(17,000)	-	(11,000)	-
業務協理	高鴻彰	-	-	-	-
協理	陳南誠	-	-	-	-
處長	蔡嘉農	2,207	-	(2,207)	-

(註)王文信於114.11.24辭任獨立董事，並於115.2.25新任副總經理。

(二)董事、監察人、經理人及持股 10%以上大股東股權移轉或股權之相對人為關係人:

姓名	股權移 轉原因	交易日期	交易相對 人	交易相對人與公司、 董事、監察人、經理 人及持股比例超過百 分之十股東之關係	股 數	交易價格
王嘉煌	贈與	114.3.14	盧忻杰	經理人本人	5,000	0
王嘉煌	贈與	114.9.10	謝東昇	經理人本人	10,000	0
王嘉煌	贈與	114.9.10	陳南誠	經理人本人	10,000	0

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115 年 4 月 18 日

姓名	本人 持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱	關係	
和威投資股份有限公司 代表人：王嘉煌	3,499,559	9.71	-	-	-	-	-	-	-
	611,820	1.70	-	-	-	-	-	-	-
新制勞工退休基金 113 年第 1 次 全權委託摩根投資專戶	2,991,318	8.30	-	-	-	-	-	-	-
華南商業銀行信託部受託保管安聯 台灣科技證券投資信託基金專戶	1,672,000	4.64	-	-	-	-	-	-	-
李振昆	1,365,155	3.79	-	-	-	-	-	-	-
力親投資（股）公司 代表人：周宜靜	1,159,056	3.22	-	-	-	-	劉燈桂	力親投資(股)公司之監察人	-
	-	-	-	-	-	-	劉燈桂	與代表人為配偶	-
劉燈桂	1,114,962	3.09	-	-	-	-	力親投資(股)公司 力全興業(股)公司 力本國際(股)公司	與代表人為配偶	-
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威 中央銀行－外部經理人摩根資產管 理（歐洲）有限公司（JPMAME） 投資專戶	1,083,377	3.01	-	-	-	-	-	-	-
	1,053,687	2.92	-	-	-	-	劉燈桂	力本國際(股)公司之監察人	-
力本國際（股）公司 代表人：周宜靜	-	-	-	-	-	-	劉燈桂	與代表人為配偶	-
力全興業（股）公司 代表人：周宜靜	1,053,687	2.92	-	-	-	-	劉燈桂	力全興業(股)公司之監察人	-
	-	-	-	-	-	-	劉燈桂	與代表人為配偶	-
兆豐國際商業銀行受託保管安聯台 灣大壩證券投資信託基金專戶	877,000	2.43	-	-	-	-	-	-	-

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
WINWAY INTERNATIONAL CO., LTD.	6,580,000	100.00%	-	-	6,580,000	100.00%
WINWAY TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC.	61,934	100.00%	-	-	61,934	100.00%
磐時電子科技(蘇州)有限公司	不適用 (註 1)	100.00%	-	-	不適用 (註 1)	100.00%
WINWAY MALAYSIA SDN.BHD.	(註 2)	(註 2)	-	-	-	-

(註 1):非股份有限公司未發行股票，本公司係以股權比例表示。

(註 2)於民國一一四年設立登記於馬來西亞，截至民國一一四年十二月三十一日止，尚未注資該公司。

參、募資情形

一、資本及股本

(一) 股本來源

1. 股份種類

115 年 4 月 18 日；單位：股

股 種	份 類	核 定 股 本			備 註
		流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
普	通	36,041,642 股	63,958,358 股	100,000,000 股	

2. 股本形成經過

115 年 4 月 18 日；單位：股；新台幣元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
114.03	10	100,000,000	1,000,000,000	35,860,326	358,603,260	公司債轉換 普通股、 註銷限制員 工權利新股	無	註 1
114.05	10	100,000,000	1,000,000,000	35,850,126	358,501,260	註銷限制員 工權利新股	無	註 2
115.08	10	100,000,000	1,000,000,000	36,049,182	360,491,820	發行限制員 工權利新 股、註銷限 制員工權利 新股	無	註 3
115.12	10	100,000,000	1,000,000,000	36,041,642	360,416,420	註銷限制員 工權利新股	無	註 4

註 1：經濟部經園投輔字第 1140102612 號函核准。

註 2：經濟部經園投輔字第 1140010008 號函核准。

註 3：經濟部經園投輔字第 1140017252 號函核准。

註 4：經濟部經園投輔字第 1140109667 號函核准。

(二)主要股東名單:持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東

115年4月18日；單位：股

股份 主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例(%)
和威投資股份有限公司	3,499,559	9.71
新制勞工退休基金113年第1次全權委託摩根投資專戶	2,991,318	8.30
華南商業銀行信託部受託保管安聯台灣科技證券投資信託基金專戶	1,672,000	4.64
李振昆	1,365,155	3.79
力親投資股份有限公司	1,159,056	3.22
劉燈桂	1,114,962	3.09
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行－外部經理人摩根資產管理(歐洲)有限公司(JPMAME)投資專戶	1,083,377	3.01
力本國際股份有限公司	1,053,687	2.92
力全興業股份有限公司	1,053,687	2.92
兆豐國際商業銀行受託保管安聯台灣大壩證券投資信託基金專戶	877,000	2.43

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策：

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐及彌補累積虧損後，先提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限，再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘則由董事會擬定盈餘分派案，提請股東會決議分派股東紅利。

本公司依公司法第240條第5項規定，分派股息及紅利之全部或一部如以現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司目前產業發展屬成長階段，配合公司未來之長期財務規劃、投資環境、及產業競爭狀況，股利之分派應考慮公司未來之資本支出預算及資金需求。當年度股東紅利之發放，以不低於該剩餘之可分配盈餘之百分之十，依股東持股比例，派付股利予股東，現金股利之分派比例不低於分派股利總額之百分之十。

本公司依公司法第241條第1項規定，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金，以發放現金方式時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議之，並報告股東會。

2.本年度已議股利分配之情形：

本公司依115年2月25日董事會決議，配發股東紅利-現金股利893,731仟元(每股配發新臺幣25元)；以超過票面金額發行普通股溢價之資本公積提撥新臺幣893,731仟元發放現金(每股配發新臺幣25元)，並將提報115年股東常會報告。

(四)年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本年度並無擬議之無償配股，故不適用。

(五)員工、董事酬勞

1.公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五，且不高於百分之十五為員工酬勞及提撥不高於百分之三為董事酬勞。

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之三十為基層員工分派酬勞。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

員工酬勞及董事酬勞係以章程所定之成數為估列基礎，認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。

3.董事會通過分派

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於115年2月25日董事會決議以現金方式分派114年度員工酬勞226,465仟元及董事酬勞11,323仟元，與本公司114年度估列金額並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司於114年2月26日董事會決議以現金方式分派113年度員工酬勞160,205仟元及董事酬勞8,010仟元，與本公司113年度估列金額並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

(一) 公司債辦理情形

公 司 債 種 類		第二次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		115 年 2 月 5 日
面 額		100,000 元
發行及交易地點		國內
發 行 價 格		以票面金額 130.03%發行
總 額		3,000,000,000 元
利 率		票面利率 0%
期 限		3 年期 到期日：118 年 2 月 5 日
保 證 機 構		不適用
受 託 人		兆豐國際商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構		凱基證券股份有限公司
簽 證 律 師		翰辰法律事務所邱雅文律師
簽 證 會 計 師		不適用
償 還 方 法		到期一次還本，詳細請參閱本公司債之發行及轉換辦法
未 償 還 本 金		-
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款		依發行及轉換辦法第 18 條
信用評等機構名稱、評等日期、 公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至年報刊印日止，本債券尚未開始轉換
	發行及轉換（交換或認股）辦法	本辦法已公告於公開資訊觀測站。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		請參閱本公司國內第二次無擔保轉換公司債之公開說明書第 72~74 頁。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

(二)轉換公司債資料

截至年報刊印日止，國內第二次無擔保轉換公司債尚未開始轉換。

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權憑證辦理情形

無。

六、限制員工權利新股辦理情形

(一) 尚未全數達既得條件之限制員工權利新股辦理情形

115年04月18日

限制員工權利新股種類	111 年限制員工權利新股	
申報生效日期及總股數	111 年 7 月 22 日 500,000 股	
發行日期	111 年 8 月 12 日	112 年 7 月 21 日
已發行限制員工權利新股股數	250,000 股	250,000 股
尚可發行限制員工權利新股股數	0 股	
發行價格	0	
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.70%	0.70%
員工限制權利新股之既得條件	1. 員工獲配限制員工權利新股後，員工可既得股份數量採分年結算，各年度之限制員工權利新股實際可既得股份比例為： 獲配日後任職屆滿 1 年最高既得比例為 30% 獲配日後任職屆滿 2 年最高既得比例為 30% 獲配日後任職屆滿 3 年最高既得比例為 40% 並以(1)個人工作績效及(2)營運績效之評估指標達成程度，依權重加權計算： (1)個人工作績效(指標權重:20%) 獲配日後任職屆滿日前 4 季度個人工作績效評核分數至少 2 季度達「B」以上。 (2)營運績效：以基本每股盈餘為營運績效標準(指標權重:80%) A.各該任職屆滿日前一年度會計師查核之年度合併財務報表之基本每股盈餘<10 元/股，可既得該年度最高既得比例之 60%。 B.各該任職屆滿日前一年度會計師查核之年度合併財務報表之基本每股盈餘為 10 元~15 元/股，可既得該年度最高既得比例之 70%。 C.各該任職屆滿日前一年度會計師查核之年度合併財務報表之基本每股盈餘為 15 元~20 元/股，可既得該年度最高既得比例之 80%。 D.各該任職屆滿日前一年度會計師查核之年度合併財務報表之基本每股盈餘為 20 元~25 元/股，可既得該年度最高既得比例之 90%。 E.各該任職屆滿日前一年度會計師查核之年度合併財務報表之基本每股盈餘為 25 元~30 元/股，可既得該年度最高既得比例之 100%。	

員工限制權利新股之受限制權利	1.員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。 2.股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託契約執行之。 3.員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，除不得參與配股配息和現金增資之認股權外，其他權益與本公司已發行普通股股份相同（包括但不限於減資、及或因合併、分割、股份轉換等各項法定事由所獲配之任何權益，以下合稱「獲配權益」）。獲配權益不需交付信託保管且不受既得期間之限制。 4.既得期間內如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件及期限後才得交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
限制員工權利新股之保管情形	限制員工權利新股發行後，應交付信託保管，由本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	1.員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。 2.員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理： (1)自願離職： 未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 (2)留職停薪： 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因，經由本公司特別核准之留職停薪員工，未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。 (3)退休： 未達成既得條件之限制員工權利新股，應自退休日起或被給予限制員工權利新股屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，視為依既得條件之時程比例達成既得條件。 (4)死亡： 未達成既得條件之限制員工權利新股，喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 (5)因受職業災害殘疾或死亡者： A. 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職日起或被給予限制員工權利新股屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，視為依既得條件之時程比例達成既得條件。 B. 因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，由繼承人於被繼承員工死亡當日起或被給予限制員工權利新股屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，視為依既得條件之時

	程比例達成既得條件。 (6)資遣： 未達成既得條件之限制員工權利新股，自資遣生效日起即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷，或得由董事長於既得條件之時程比例範圍內，核定其達成既得條件比例及時限。 (7)調職： 如員工調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其未達成既得條件之限制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟，為應本公司之要求而調動者，得由董事長於既得條件之時程比例範圍內，核定其達成既得條件比例及時限。	
已收回或收買限制員工權利新股股數	54,260 股	37,840 股
已解除限制權利新股之股數	195,740 股	119,760 股
未解除限制權利新股之股數	0 股	92,400 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0%	0.26%
對股東權益影響	對本公司基本每股盈餘稀釋尚屬有限，對現有股東權益尚無重大影響	

115年04月18日

限制員工權利新股種類	114 年限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	114 年 7 月 29 日 200,000 股
發 行 日 期	114 年 8 月 13 日
已發行限制員工權利新股股數	200,000
尚可發行限制員工權利新股股數	0 股
發 行 價 格	0
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.55%
員工限制權利新股之既得條件	1. 員工獲配限制員工權利新股後，員工可既得股份數量採分年結算，各年度之限制員工權利新股實際可既得股份比例為： 獲配日後任職屆滿 1 年最高既得比例為 30% 獲配日後任職屆滿 2 年最高既得比例為 30% 獲配日後任職屆滿 3 年最高既得比例為 40%

	每年並以個人工作績效計算實際既得比例： 獲配日後任職屆滿 1 年 (1) 前年度個人績效等第至少一次達「B」以上且無「D」或「E」者 100%。 (2) 前年度個人績效等第兩次「C」者 70%。 (3) 前年度個人績效等第有任何「D」或「E」者 0% 獲配日後任職屆滿 2 年及 3 年 考績與最高既得比例依前述標準，但最終比例須與上一年度結果相乘，舉例如下表。 <table><tr><th>舉例</th><th>滿 1 年</th><th>滿 2 年</th><th>滿 3 年</th></tr><tr><td>Case 1: (B/B/B)</td><td>B: 100%</td><td>B: 100%*100%=100%</td><td>B: 100%*100%*100%=100%</td></tr><tr><td>Case 2: (B/C/B)</td><td>B: 100%</td><td>C: 100%*70%=70%</td><td>B: 100%*70%*100%=70%</td></tr><tr><td>Case 3: (C/C/C)</td><td>C: 70%</td><td>C: 70%*70%=49%</td><td>C: 70%*70%*70%=34.3%</td></tr><tr><td>Case 4: (C/D/C)</td><td>C: 70%</td><td>D: 70%*0%=0%</td><td>C: 70%*0%*70%=0%</td></tr></table>	舉例	滿 1 年	滿 2 年	滿 3 年	Case 1: (B/B/B)	B: 100%	B: 100%*100%=100%	B: 100%*100%*100%=100%	Case 2: (B/C/B)	B: 100%	C: 100%*70%=70%	B: 100%*70%*100%=70%	Case 3: (C/C/C)	C: 70%	C: 70%*70%=49%	C: 70%*70%*70%=34.3%	Case 4: (C/D/C)	C: 70%	D: 70%*0%=0%	C: 70%*0%*70%=0%
舉例	滿 1 年	滿 2 年	滿 3 年																		
Case 1: (B/B/B)	B: 100%	B: 100%*100%=100%	B: 100%*100%*100%=100%																		
Case 2: (B/C/B)	B: 100%	C: 100%*70%=70%	B: 100%*70%*100%=70%																		
Case 3: (C/C/C)	C: 70%	C: 70%*70%=49%	C: 70%*70%*70%=34.3%																		
Case 4: (C/D/C)	C: 70%	D: 70%*0%=0%	C: 70%*0%*70%=0%																		
員工限制權利新股之受限制權利	1. 員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。 2. 股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託契約執行之。 3. 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，除不得參與配股配息和現金增資之認股權外，其他權益與本公司已發行普通股股份相同（包括但不限於減資、及或因合併、分割、股份轉換等各項法定事由所獲配之任何權益，以下合稱「獲配權益」）。獲配權益不需交付信託保管且不受既得期間之限制。 4. 既得期間內如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件及期限後才得交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。																				
限制員工權利新股之保管情形	限制員工權利新股發行後，應交付信託保管，由本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。																				
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	1. 員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。 2. 員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理： (1)自願離職： 未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 (2)留職停薪： 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因，經由本公司特別核准之留職停薪員工，未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。																				

	(3)退休： 未達成既得條件之限制員工權利新股，應自退休日起或被給予限制員工權利新股屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，視為依本條第(二)項既得條件之時程比例達成既得條件。 (4)死亡： 未達成既得條件之限制員工權利新股，喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 (5)因受職業災害殘疾或死亡者： A. 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職日起或被給予限制員工權利新股屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，視為依本條第(二)項既得條件之時程比例達成既得條件。 B. 因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，由繼承人於被繼承員工死亡當日起或被給予限制員工權利新股屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，視為依本條第(二)項既得條件之時程比例達成既得條件。 (6)資遣： 未達成既得條件之限制員工權利新股，自資遣生效日起即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷，或得由董事長於本條第(二)項既得條件之時程比例範圍內，核定其達成既得條件比例及時限。 (7)調職： 如員工調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其未達成既得條件之限制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟，為應本公司之要求而調動者，得由董事長於本條第(二)項既得條件之時程比例範圍內，核定其達成既得條件比例及時限。
已收回或收買限制員工權利新股股數	0股
已解除限制權利新股之股數	0股
未解除限制權利新股之股數	0股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0.55%
對股東權益影響	對本公司基本每股盈餘稀釋尚屬有限，對現有股東權益尚無重大影響

(二)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大員工之姓名、取得情形

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之占已發行總股份比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行總股份比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行總股份比率
經理人	總經理	王嘉煌	182,000	0.51%	63,600	0	0	0.18%	118,400	0	0	0.33%
	資深副總經理	陳紹焜										
	資深副總經理	李振昆										
	副總經理	謝東昇										
	副總經理	盧忻杰										
	資深協理	張漢政										
	協理	陳南誠										
	業務協理	高鴻彰										
	處長	蔡嘉農										
員工	技術處長	孫家彬	109,000	0.30%	42,000	0	0	0.12%	67,000	0	0	0.18%
	處長	沈曉佩										
	副處長	尤喬維										
	副處長	張凱韋										
	副處長	陳世欣										
	資深經理	黃瑞隆										
	資深經理	楊國材										
	副理	余丁沛										
	副理	鄭凱文										
	副理	張皓閔										

註1：已發行股數係指經濟部變更登記資料所列股數。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
無。

八、資金運用計畫執行情形

截至年報刊印日之前一季止，本公司並無前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務之主要內容：

- CB01010 機械設備製造業
- CA02990 其他金屬製品製造業
- CC01080 電子零組件製造業
- F106010 五金批發業
- F113010 機械批發業
- F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- F118010 資訊軟體批發業
- F206010 五金零售業
- F218010 資訊軟體零售業
- F219010 電子材料零售業
- F401010 國際貿易業
- I301010 資訊軟體服務業
- I501010 產品設計業
- IZ99990 其他工商服務業
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2.公司目前之產品及其營業比重：

單位：新台幣千元

主要產品	113 年度		114 年度	
	營業收入	比重	營業收入	比重
測試治具 Test Sockets	4,097,859	71%	4,401,474	56%
接觸元件 Contact Element	642,782	11%	816,958	10%
探針卡 Probe Card	640,723	11%	2,306,741	30%
其他 Others	416,732	7%	332,006	4%
合計	5,798,096	100%	7,857,179	100%

3.公司目前之商品（服務）項目

- A. 高效能半導體測試治具(Advanced Test Socket)
- B. 接觸元件(探針/導電橡膠/ i-Bump)
- C. 測試機台轉換治具(Changeover Kit of handler)
- D. 感光元件/高頻測試/記憶模組測試治具(CMOS/RF/Memory Module Test Socket)
- E. 主動式溫度控制(Active Thermal Controller)
- F. 老化測試治具(Burn-in Socket)
- G. 垂直式探針卡(Vertical Probe Card)
- H. 基板(Substrate)和載板設計 (Load Board Design)
- I. 彈簧針設計暨製造(Spring probe)
- J. 高效率主動式溫度控制器(HEATCon Series)

- K. 224Gbps 高速暨高頻同軸測試治具(Brownie 2.0 Coaxial Socket)
- L. 高功率廣溫域主動式溫度控制器(E Flux series)
- M. 晶圓級上下對位封裝晶片測試介面系統(Double Sided Probing System Total Solution)
- N. 自動換針機設備 (Auto re-pin machine)

4.計畫開發之新商品(服務)

本公司依技術提升及市場需求規劃未來新產品、新技術開發方向。

- A. 微間距探針卡(Fine Pitch Probe Card)
- B. 速暨高頻同軸測試治具優化
- C. 高效率主動式溫度控制器優化
- D. 客製化老化測試治具(Customized Burn-in Socket)
- E. 接觸元件設計、製造與材料開發(Design, fabrication and material development of contact element)
- F. 基板 (Substrate),載板設計和組裝(Load Board Design & Assembly)
- G. MEMS探針卡 (MEMS Probe Card)
- H. 探針組裝自動化設備 (Probe Assembly Automation Equipment)
- I. 探針卡自動量測機 (MEMS Probe Card Automated Measurement System)
- J. 高速暨高頻同軸探針測試座Warpage優化方案
- K. 式溫度控制器 (HEATCon Nova)
- L. 功率廣溫域主動式溫度控制器 (E-Flux 7.0)
- M. 高功率冰水機 (Chiller)
- N. 液冷散熱測試治具 (Liquid cooling Socket System)
- O. 電子元件VC均熱板散熱器 (Electronic Vapor Chamber HeatSink)
- P. 微通道散熱冷卻技術 (Micro-Channel)
- Q. 高導熱材料 (異質合金Adapter、高效能暨可壓縮型TIM)
- R. 智慧型高功率動態多點式Tc/Tj溫控器 (Multi-point temp. control)
- S. 溫控設備自我診斷功能 (Self-Test / Self-Diagnosis)
- T. 熱管理暨簡易測試分選機 (Thermal Control user-friendly Test Handler)
- U. 接觸元件 (共地暨高剛性導電膠、異質強化型導電膠)
- V. 微間距薄板非接觸式製造設備

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

從各大指標研調機構數據顯示，全球半導體產值將在 2026 年提前達到一兆美元。根據 SEMI 報告指出，AI 發展推升晶片與記憶體漲價的雙重因素下，全球半導體產業 2025 年營收達 7,750 億美元，預計 2026 年將突破 1 兆美元，較原先預期提早 4 年達成 1 兆美元目標，並預估 2035 年將超越 2 兆美元。

Source: SEMI ,年度會員問卷調查,2026, Mar.

同時，根據全球半導體貿易統計協會(WSTS)的數據顯示，全球半導體市場2026年將成長超過25%，達到9,750億美元，其中記憶體和邏輯裝置將是主要成長動能，兩者年增長率均將超過30%。

WSTS Forecast Summary

Autumn 2025	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Americas	195,123	251,926	338,574	45.2	29.1	34.4
Europe	51,250	54,127	60,429	-8.1	5.6	11.6
Japan	46,739	44,835	50,164	0.0	-4.1	11.9
Asia Pacific	337,437	421,354	526,293	16.4	24.9	24.9
Total World - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3
Discrete Semiconductors	31,026	30,900	33,436	-12.7	-0.4	8.2
Optoelectronics	41,095	42,597	45,020	-4.8	3.7	5.7
Sensors	18,923	20,894	22,713	-4.1	10.4	8.7
Integrated Circuits	539,505	677,852	874,291	25.9	25.6	29.0
Analog	79,588	85,552	91,988	-2.0	7.5	7.5
Micro	78,633	84,839	96,620	3.0	7.9	13.9
Logic	215,768	295,892	390,863	20.8	37.1	32.1
Memory	165,516	211,568	294,821	79.3	27.8	39.4
Total Products - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3

在人工智慧 (AI) 浪潮推升下，全球半導體產業迎來前所未有的成長動能，半導體需求來的又急又快，全球進入半導體史上最迅猛的成長週期。

半導體製程不斷推進，運算需求持續增加，人工智慧(AI)出現，更加速半導體產業在 2025 年的大幅成長，根據 SEMI 指出，目前 AI 投資大多集中在訓練(Training)模型，預計 2030 年後，將有六成以上的應用轉向推論 (Inference)，意味著 AI 將從雲端資料中心大規模擴散至邊緣裝置 (EdgeDevices)，成為整體半導體產值在 2035 年衝破 2 兆美元的核心引擎。

在生成式 AI 推動下，AI 應用百花齊放，從企業級別走向從消費級推升至建置 AI 基礎設施，包括 Agentic AI、Sovereign AI、企業級 AI、Physical AI、機器人等，從大型語言模型逐漸衍伸更多樣的多模態模型。晶圓代工先進製程今年將從奈米時代進入到埃米 (Angstrom)，透過晶背供電，持續提高晶片密度、晶片速度，以及功耗降低等，朝物理極限逼近；由此，半導體產業的關鍵和瓶頸，從製造逐漸轉向先進封裝。根據 TrendForce，過去半導體設備投資約有 80-90% 集中於前段製造設備，現在已有部分先進封裝相關設備已超越前段製程；同時更有研調機構指出，先進封裝市場已經正式於 2025 年超過傳統封裝，達 51.03%，可見先進封裝製程在半導體產業中的重要性逐步提升，且成長強勁。 (Source: TrendForce、Yole)

由此，在「縮小電晶體」之外，先進封裝技術成為最佳解方，產業界開始熱烈討論各種先進封裝技術，包括 SoIC、CoWoS、InFO 等技術，更有扇外型晶圓級封裝(FOWLP)、2.5D/3D IC 封裝、系統級封裝(SiP)等解決方案。不只封裝重要性逐步增加，在 AI 需求趨動下，由於測試流程越來越長、封裝及測試複雜度提升，測試的重要性與日俱增，從晶圓測試(CP)、最終測試 (FT)、系統測試(SLT)、老化測試 (Burn-in)等，更逐漸形成下一個大趨勢。由此，對於半導體測試介面而言，AI 使終端產品往大容量、高頻寬、高速率、大功耗、高度整合等趨勢靠攏，因此帶動封裝體越來越大、測試時間越來越長、功耗越來越高、先進製程時間加長，進入產業典範的轉移與質變，也帶來無限的商機。

公司為了抓住此商機，提前於高階產品布署，包括高頻測試座（Coaxial Socket）的推陳出新，以及超導體測試座家族（HyperSocket™ Series）如進階版超導測試座 HyperSocket™-UF、HyperSocket™-LF、HyperSocket™-DH 等，同時升級老化測試座達到高速老化測試（Functional Burn-in）；此外，為追求更大幅的成長，公司於 2025 年正式跨足探針卡（MEMS/Cobra Probe Card）、等，上述產品布局，都將滿足半導體測試介面上述大趨勢與市場需求，在 AI 世代中，用「AI」（Alliance & Integration）占得市場先機。

2. 產業上、中、下游之關聯性

在 IC 測試時，為滿足各類產品測試規格需求，測試介面在產業鏈扮演關鍵角色。為使測試機台（ATE）和待測物（DUT）有良好的接合，就必須客製化設計不同的測試介面，讓待測物特性（Function and Performance）完整呈現。而本公司目前主要產品為各類半導體測試介面（Test Interface）。

半導體測試介面的精密加工過程複雜，公司在關鍵與核心元件皆為自主製造，打造 Socket-All-in-House 解決方案；然而製造過程所需零組件數量眾多，部份零件加工係委外協力廠商負責。從所屬行業上下游關聯來看，本公司係屬研發、設計、製造、組裝並銷售各類測試介面予半導體等產業之上下游廠商，上游為 IC 設計及晶圓製造公司，下游則為 IC 封測廠，其產業相關之上下游關聯性列示如下：



3. 產品之各種發展趨勢

在半導體市場中，微縮製程持續推進、先進封裝測試逐在產業地位重要性逐漸升高，尤其晶圓級測試需求越來越大，半導體測試介面將扮演越來越重要的角色。公司在產品持續推陳出新，高度客製化更貼近客戶所需。未來公司研發人員及其學經歷的配置將著重於研發重點項目：腳距密集化探針卡(Fine Pitch Probe Card)、高頻測試治具(Coaxial Socket)、主動式溫控平台(ATC)及被動式散熱手測蓋(Heatsink Lid)、車用 IC 高低溫/高速老化測試(Functional Burn-in)及共同封裝光學元件測試介面(Co-packaged optical components test interface)，此為半導體長期趨勢，也是本公司大量投入研發資源的領域。

A.腳距密集化探針卡/0.12mm fine pitch probe card：

摩爾定律定義為兩大定義：1.積體電路晶片上所整合的電晶體數目，每隔 18 個月就倍增。2.微處理器的效能每隔 18 個月提高一倍。隨著摩爾定律的推進，半導體製程不斷地微縮，伴隨而來的就是晶片內含的邏輯閘數目上升，同時對外的信號接腳數目也往上提高，信號傳輸時脈也相對應上升。AI、HPC 應用則為半導體晶片製程微縮的催化劑，在半導體製程微縮逐漸走向物理極限同時，新的晶片封裝技術如 CoWoS, Chiplet, SoIC 等高階封裝亦不斷地在推陳出新。展望未來，半導體測試介面如何與 IC 設計客戶共同研究開發以因應未來先進封裝及測試需求，為產業一大挑戰，在半導體供應鏈所扮演的角色也日益重要。

B.高頻測試治具/Coaxial socket：

在 IC 製程中，測試分為兩階段：前段測試也就是所謂的晶圓測試(Wafer Probing or Circuit Probing)，此時是直接利用探針卡來量測晶圓上的 IC 功能是否符合當初預期之設計規格，若符合規格才會送往封裝廠進行封裝的動作。在封裝結束後會再做一次 IC 測試，也就是所謂的最終測試(Final Test)，此時的測試主要是測試封裝後的 IC 功能是否符合設計規格，等完成這一段複雜的測試程序後，才會將 IC 出貨至客戶端。彈簧針測試插座(Pogo-pins test socket)通常作為封裝 IC 之測試介面，隨著應用於數位/射頻 IC 測試系統的操作頻率到達了 GHz 的範圍，在以前常忽略之測試介面高頻寄生效應，如今成為測試上難以滿足訊號完整性要求的重大瓶頸。因此，如何降低訊號衰減則為此計畫最重要的關鍵技術。

C.廣溫域IC測試溫控平台/ATC

積體電路在生產過程中，由於製造過程中可能會出現微細缺陷結構導致產品操作品質不穩定，進而影響產品可靠度及使用壽命。此計畫目標為持續提高產品操作的極限溫度環境加以測試其半導體元件品質，透過極限環境的影響達到拓寬元件設計安全使用範圍，延長產品的生命週期及提高產品的可靠度。另外一方面，由於產品初期設計即必須要考慮到不同的使用者環境，例如南北極圈、赤道…等極端環境惡劣的地方，因此，開發一套完整的溫度控制平台為半導體測試業者不可或缺的利器。此計畫的目的為開發一套溫控功能強大且符合各種溫度測試平台的溫控設備，加以改善之前產品的溫控極限，將可操作的溫度範圍擴大至-60°C 到 150°C。

D.接觸元件開發

電子封裝元件市場除了高腳數高階電子產品外，消費性電子產品市場的興起，包含晶圓凸塊技術(wafer bumping)、晶圓級封裝 (WLCSP)、扇外型晶圓級封裝(Fan Out WLP)、3D 晶圓級封裝(3D WLP)、晶圓級光學封裝 (WL optics)等)以及 3D 封裝的 IC (3D IC)，這些技術型態稱為中段(Mid End)。而介於後段封測與 PCB 技術中也興起了新技術，如嵌入式元件載板(Embedded Substrate)技術和矽/玻璃中介層(Si/Glass interposer)。因應此類產品的測試需求，預期開

發多款新型接觸元件(contact element)，此為測試治具或探針卡最重要和關鍵的技術。

E. 車用IC高低溫/老化測試

由於自駕車市場的未來市場蓬勃發展，全球知名半導體設計公司皆投入大量研發資源於車用相關 IC 應用，且由於車用規格條件較工業及商業用途嚴苛許多，因此對於晶片高低溫及其可靠度測試，所需要的高性能 IC 測試治具有著更高要求。

F. 矽光子晶圓級光學 CPO 測試介面解決方案

為滿足產業對於高速運算與傳輸需求，進而帶動對資料中心（data center）、雲端運算（cloud computing）源源不絕的效能提升，同時也帶來高速傳輸的挑戰，傳統的電訊傳輸逐漸達到無法突破的極限，光訊號傳輸成為新一代解方，使矽光子（Silicon Photonics）及共同封裝光學元件（Co-Packaged Optics, CPO）遂成為半導體產業的下一步主流，同時帶給半導體測試介面新的挑戰和商機。

G. 超大封裝解決方案 HyperSocket™

HyperSocket™ 系列專為超大封裝、且針對高敏感接觸電阻測試需求而開發的次世代系列產品，它採用柔性接觸介面設計，可有效避免對測試過程中，探針和錫球接觸過程中造成損傷。此創新結構大幅延長彈簧探針的使用壽命，降低清潔頻率，並且使生產效率最化。

4. 競爭情形

本公司目前主要競爭對手屬日本、韓國或歐美等廠商，本公司在台灣、中國大陸與東南亞長期深耕，具備在地的即時服務能力，為本公司維持良好客戶關係的競爭實力之一。

面對邏輯 IC 封裝的多樣性，對應於測試治具和探針卡需求漸長，測試條件要求越趨嚴格，憑藉著本公司與客戶需求一同成長進步的研發能力、在生產管理上的彈性應變能力，以及持續為客戶提供專業的客製化產品與優質服務，為本公司強大的護城河。

A. 亞洲市場

隨著製程推進、先進封裝趨勢確立，本公司的產品策略放在高階測試需求的市場上，提供客戶專業、高品質的測試產品與服務，針對客戶特殊的產品需求，提供客製化規格且共同研發、設計合宜的產品。

科技產品迭代速度越來越快，為了爭取到更多新的市場版圖，也與既有的產品市場區隔，本公司持續專注於高階市場外，針對中低階市場，亦有合適的產品因應。

B. 東南亞市場

半導體 IC 產業聚落，除了台灣、中國大陸外，東南亞如新加坡、馬來西亞亦為半導體產業重鎮，其半導體相關產業發展與生態系已漸趨成熟，不少歐美 IC 設計大廠將亞洲據點設立於新加坡，而馬來西亞與菲律賓則就近成為生產、製造基地，就近供應市場需求。

此外，因應高速運算（High Performance Computing）產品快速成長，同時在半導體供應鏈地緣效應下，半導體封測製造板塊位移趨勢逐漸成形，在東南亞半導體設計及封測客戶第一線支援與服務的需求亦趨重要。

本公司於 2023 年 5 月於馬來西亞檳城設置業務及技術服務中心(WinWay Penang Service Center)，2024 年底成立馬來西亞子公司，就近服務當地半導體 IC 設計及封測客戶，未來將持續深耕東南亞市場，與客戶一同成長，擴大商機。

C. 美國市場

美國市場為全球科技龍頭及半導體 IC 設計產業的最大戰場，新一代產品的開發、設計、研發，皆需要供應商第一時間的支援，設計取勝將決定量產的訂單。除了傳統 ATE 測試的需求，系統級測試 (SLT) 的需求將帶來新世代產品測試的龐大商機。本公司多元化的產品與服務，為客戶解決新產品的測試挑戰。

本公司之生產及服務以台灣為中心，在美國設立子公司，並且有堅實的技術服務團隊及業務團隊提供客戶第一線生產的支援與服務方面，並且擴大雇用在地員工 (Local hire)，以強化在地化的支援、服務、交貨，更可提供給歐美的 IC 設計及製造廠商採用的解決方案。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次及研究發展

本公司目前以發展前瞻之技術或知識，開發核心應用創新技術、產品價值、技術等需求為首要目標；致力成為世界領先第一的 IC 測試介面供應商，並提供 IC 測試介面整合設計與製造的專業服務。研發重點項目列舉如下：

- 微間距探針卡 (Fine Pitch Probe Card)
- 各式測試應用測試治具及手測蓋
- 高速暨高頻同軸測試治具 (Brownie Coaxial Socket)
- 高效率主動式溫度控制器 (HEATCon & ATC& E-Flux)
- 客製化老化測試治具 (Customized Burn-in Socket)
- 毫米波專用測試治具 (mmWave test socket)
- 自動化設備 (Automated equipment)
- 接觸元件設計與材料開發 (Design and material development of contact element)
- 共同封裝光學元件測試介面開發 (Co-Packaged Optics Test Solution)

本公司為國內少數可提供高效能 IC 測試治具的專業半導體測試介面製造商，由於半導體產業分工合作細膩、緊密，且在開發階段即需要進行產品驗證需求，且在半導體測試介面的需求是相當重要的一環。本公司有幸與國際大廠在產品發展前

期一同合作開發所需的高階測試功能治具，進而延伸至下游測試廠提供一完整的測試介面設備。

我們所擁有的優勢可從以下幾點明顯點出：

A.擁有卓越測試經驗：

- a.在 IC 測試領域已擁有 20 年以上的經歷。
- b.內部測試生產線維修與故障排除。
- c.在整合設計與改善多種測試治具、接觸元件、測試機，及 Handler 測試介面上的經歷相當豐富。

B.專業能力：

- a.開發多種適用性封裝產品之測試治具，如 AIP(封裝天線，Antenna in Package)，2.5D Interposer (中介層封裝)，3D CoWoS 封裝，SIP(系統級封裝，System in Package)，BGA(球柵陣列封，Ball Grid Array)、WLCSP(晶圓級尺寸封裝，Wafer Level Chip Scale Package)、POP(堆疊式封裝 IC，Package on Package)、共同封裝光學元件(Co-Packaged Optics)，且亦涵蓋第三代半導體材料測試需求。
- b.開發高性能測試治具，頻寬可涵蓋目前市場主流應用已從 112Gbps 提升至 224Gbps，球間距為 0.12mm~1.27mm。
- c.開發高功率散熱測試器，應用多種新穎散熱技術於產品測試平台。
- d.蝕刻/微影/電鍍等精密製造技術。
- e.精密微細孔加工技術。
- f.機構/電性/熱傳模擬能力。

2.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位:新台幣千元

項目	113 年度	114 年度
研發費用	347,159	416,122
營業收入	5,798,096	7,857,179
研發費用占營業收入淨額比例(%)	5.99	5.30

3.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	產品名稱
103 年	1.ATC 主動式溫度控制器開發 2.高頻、機構及熱流模擬能力建立 3.Fine Pitch 微細孔加工及量測技術開發 4.Random PCR 分散式導電接觸元件開發及應用 5.PCR+Plunger socket 開發
104 年	1.Direct Dock Probe Card 開發 2.Sandwich Coaxial socket(高頻測試治具)開發 3.Thermal socket (散熱功能測試治具)開發 4.Oil bath socket (油浴測試治具)開發

	5.高頻 RF 量測能力建立 6.廣溫域 IC 測試溫控平台開發 7.新式接觸元件 C-Pin 開發 8. i-Bump + Plunger socket(獨立式導電柱+銅柱測試治具)開發
105 年	1.Wall extension coaxial socket (擋牆式高頻測試治具)開發 2.CR tester(接觸式阻抗測試機台)開發 3.新式接觸元件 W-Pin 開發 4.接觸元件耐電流能力建立 5.eMesh & HAH PCR(網狀式&高彈力式導電矽膠)開發及應用
106 年	1. W-Pin 開發及量產 2. ATC(主動式溫度控制器)設計優化 3. TEC(致冷晶片)新材質開發導入 4. E-Flux(高熱通量控制器 Extremely High Heat-Flux Thermal Controller) 開發 5. Air Socket(氣冷式測試治具)開發 6. P0.8 Brownie Socket(全屏蔽高頻測試治具)開發
107 年	1.P0.5 Brownie Socket(全屏蔽高頻測試治具)開發 2.HEATCon(高效率主動式溫度控制器) 3.Low Cost Pin(低成本接觸元件)開發 4.E Flux 產品升級 5.被動式散熱手測蓋 6.高頻量測與模擬優化技術 7.80um 間距探頭解決方案(Launched 80um pitch probe head solution.) 8.CP & final test turnkey solution.
108 年	1.超高速 Brownie Coaxial Socket 開發 2.低溫 HEATCon 開發案 3.E-Flux 3.1 開發 4.Brownie Lite 開發及產品導入 5.AIP Socket 開發與導入
109 年	1.Brownie 大封裝測試方案 2.自動整列壓合機開發 3.獨立溫控 Burn in Socket 開發 4.探針外觀自動檢查設備開發 5.基板(Substrate)和載板設計(Load Board Design)
110 年	1.新樣式滾動式接觸元件 2.80GHz 同軸測試方案 3.自動植針設備 4.廣溫域導電膠 5.FDR 機台 6. Brownie Lite Coaxial socket

111 年	1.高功率 E Flux 4.0 主動式溫度控制器開發 2.高效率植針設備 3.高機械強度之廣溫域彈性導電件 4.晶圓級上下對位封裝晶片測試介面系統 5.高電流(1000A)及高電壓(1200V) IC 測試治具 6.高效能散熱器(900W)、高抗力(300 公斤)工程壓測治具(Lid)
112 年	1. 自動換針設備 2. FDR 多功能測試機 3.高效率 2000W 主動式溫度控制器(HEATCon Titan) 4.高功率 E Flux 5.0 主動式溫度控制器開發 5.主動式壓力控制測試機構 (Remoted Plunger) 6.獨立溫控模組 7.微型彈性介面元件
113 年	1. 224Gbps 高速暨高頻同軸測試治具(Brownie 2.0 Coaxial Socket) 2. 超導測試座 3.高功率 E Flux 5.1 主動式溫度控制器開發 4. 探針影像自動辨別組裝設備 5. 超精密探針電鍍製程之智慧化監控與數據分析技術
114 年	1. 超大封裝超導測試應用 2. 半自動雙動式探針精密組裝設備開發 3. 高功率 E-Flux 6.0 主動式溫度控制系統開發 4. 電子元件 VC 均熱板散熱器開發 5. 高效能暨可壓縮型 TIM 6. MEMS 探針卡產品跨入 CoWoS 製程
115 年截至年報刊印日止	1. 超大封裝 Open/Short 測試座與 Load Box 開發 2. 接觸元件 (共地暨高剛性導電膠方案) 3. 微間距薄板非接觸式製造能力建立 4. 密集型多點式 Tj 溫控器開發

(四)長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

A. 產品策略

- 針對高階與中低階市場作區隔，持續提供高階產品市場相關的測試應用，同時針對中低階市場推出合適的產品因應。
- 由測試座(Test Socket)擴大發展至垂直探針卡(Vertical Probe Card)，針對既有的 Cobra 技術優化與延伸，同時跨足 MEMS 領域，深化在 MEMS 探針卡的研發與產能，提供客 CP 的測試完整解決方案。
- 持續優化高階老化測試座(Burn-In Socket)，擴大導入高速老化測試 (Functional Burn-in)。
- 對應超大封裝、高敏感接觸電阻測試需求而開發的次世代系列產品 HyperSocketTM。

B. 客戶面策略

- a. 依地區屬性劃分客戶類別，區分客戶族群為 IC 設計公司(Design House)與 IC 測試廠(Testing House)，對於不同客戶類型建立不同的業務策略。
- b. 強化全球各據點的技術服務即時應變能力，依不同地市場動態調整業務銷售策略。

C. 支援服務

持續強化客戶支援服務流程，並依客戶群分別定義出適合的流程。

2.長期業務發展計畫

A. 產品策略

- a. 持續提供高階測試座(Test Socket)以滿足微縮(Fine Pitch)與高頻(High Frequency)等高集成度之電腦及無線通訊 IC 測試需求，並擴大產能於高階產品。
- b. 維持中低階測試治具(Test Socket)種類以因應 Burn-In (老化測試), SLT(系統測試)及消費性產品測試之需求擴大市場占有率。
- c. 針對特殊型式的封裝如晶圓級封裝 (WLCSP)、2.5D / 3D (透過中介層連結晶片與基板的 I/O 以大幅提高封裝密度的技術)、堆疊式封裝 IC (POP)、直通矽晶穿孔(TSV) 先進的封測需求提供完整的解決方案。
- d. 與客戶共同研發未來特殊需求之產品線；如微機電感知器(MEMS)、汽車電子(Automotive)、物聯網(AIoT)等微型元件測試解決方案。
- e. 擴大垂直探針卡(Vertical Probe Card)產品線，提供高階晶圓測試(Wafer Test)之工程驗證及量產需求。

B. 客戶面策略

- a. 加強維護現有客戶關係，透過本公司全方位產品策略，以滿足客戶不同種類的產品線封裝測試需求，以提升客戶忠誠度。
- b. 持續保持與全球一線 (Tier One) 客戶產品開發緊密合作，共同研發前瞻性測試需求，以提升客戶的依賴度。
- c. 持續保持與各區域晶圓代工廠 (Foundry) 及封測廠(Package & Testing)合作，共同服務全球客戶。
- d. 持續擴充本公司業務及技術服務全球網路據點，保持競爭優勢。

C. 支援服務

- a. 維持優良的品質系統與優異設計能力，透過全球性支援服務，使客戶從研發設計、產品驗證到導入量產，在最短的時間內完成，為客戶產品上市時間(Time to Market)助攻。
- b. 透過本公司特有的產品異常反饋機制(RMA System)，即時收集客戶產品在全球各區域測試廠生產狀況，即時或定期與客戶召開檢討會議，以降低成本、提高產出。
- c. 透過本公司客製化之 eForecast 及 WIP 系統，確實掌握產品交期之準確性以符合客戶工程及量產需求。
- d. 本公司於台灣、東南亞、中國大陸等重要半導體測試生產基地，皆配置產品技術支援 (FAE)工程師駐廠，可即時迅速地替客戶解決生產問題。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣千元；%

地區		113 年度		114 年度	
		銷貨金額	%	銷貨金額	%
外銷	美洲	2,173,043	38%	4,053,414	52%
	中國	1,528,410	26%	1,836,380	23%
	亞洲	470,645	8%	619,734	8%
	歐洲	18,073	0%	25,492	0%
	小計	4,190,171	72%	6,535,020	83%
內銷		1,607,925	28%	1,322,159	17%
總計		5,798,096	100%	7,857,179	100%

2.市場占有率：

半導體產業鏈涵蓋廣泛，從前段晶圓設計、製造到後段封裝與測試，台灣擁有完整的半導體聚落，以及難以數計相關供應鏈。本公司產品性質屬於半導體產業鏈中測試階段，依測試條件需求與環境又可分為晶圓測試(CP)、系統測試(SLT)與最終測試(FT)，本公司主要銷售產品測試治具(Test Socket)即廣泛應用於系統測試(SLT)與最終測試(FT)。

隨著生成式人工智慧(AI)崛起，帶動半導體產業連兩年大幅成長，大型CSP業者對AI、高速運算(HPC)高度需求，驅動半導體產業成長增速，使半導體產值提前四年達到一兆美元，同時使半導體測試介面產業進入高頻高速、高複雜度的大封裝、大功耗的發展趨勢。

2026 年被視為實體AI 元年，AI從算力競賽正式進入落地與規模化應用的賽道；同時AI從機器學習、資料處理進入推論、AI agent以及Physical AI等典範轉移，除了晶片數量將帶來更高度複雜的晶片，不僅測試介面扮演角色越來越重要（More and more test insertions），且測試時間越來越長（Longer and longer testing time），在此過程中，測試量能、先進封裝都顯得更加關鍵，「穎崴半導體測試介面AI plus全方位解決方案」將成為AI世代最能滿足高階測試的解決方案。

根據Yole Group《半導體耗材--老化測試和測試座市場監測報告》指出，本公司於114年度邏輯測試座(Test Socket) 全球排名第三；邏輯測試座與老化測試座(Burn-in Socket) 併計，全球排第四。

3.市場未來之供需狀況與成長性

受 AI 基礎設施需求與尖端邏輯晶片成長帶動，半導體產業協會（SIA）預測全球產值將創歷史新高，標誌著硬體技術進入全新里程碑。根據半導體產業協會（SIA）與世界半導體貿易統計組織（WSTS）發布的最新報告，全球半導體市場在經歷 2025 年的強勁增長後，2026 年年度銷售額預計將達到 1 兆美元。

此外，WSTS 預測 2026 年全球半導體市場將成長超過 25%，達到 9,750 億美元。預計各地區與各產品類別皆將實現成長。其中，記憶體（Memory）與邏輯（Logic）將再次領先，年增率均超過 30%。其他多數產品類別則可望延續溫和復甦，並以較為穩健的速度成長。

Source: WSTS Semiconductor Market Forecast Fall 2025

2026 年被視為實體 AI 元年，AI 從算力競賽正式進入落地與規模化應用的賽道。由此，公司預期 AI 應用擴大至智慧型手機、伺服器、NB/PC、電動車等產品趨勢不變，客製化的 AI 運算晶片(ASIC)以及支援 AI 運算的網通晶片需求將大幅成長；同時 AI 從機器學習、資料處理進入推論、AI agent 以及 Physical AI 等典範轉移，除了晶片數量將帶來更高度複雜的晶片，不僅測試介面扮演角色越來越重要（More and more test insertions），且測試時間越來越長（Longer and longer testing time），在此過程中，測試量能、先進封裝都顯得更加關鍵，「穎崙半導體測試介面 AIplus 全方位解決方案」將成為 AI 世代最能滿足高階測試的解決方案。

穎崙科技持續朝向「技術自主」、「擴充產能」、「全球服務」三大方向，成為世界的供應商。

4.競爭利基

- A. 有全球化支援、服務及業務的佈局及完整健全的組織。
- B. 自製探針、Socket 設計、製造、生產能掌握技術開發及生產製造關鍵技術。
- C. 各種封裝形式均有適切的解決方案。
- D. 具有國際溝通協調人才及工程人員，為一般台灣或中國大陸廠商所無法提供。
- E. 擁有一流的研發人才，協助客戶研發新的解決方案及未來產品的解決方案。
- F. 具有針對晶圓級封裝（Chip Scale Package）測試之優越解決方案。
- G. 各種不同接觸元件(Contact Element)的方案，提供客戶最佳及最有效能的 Socket。
- H. 擁有經驗豐富的設計人員及業務人員，可協助客戶解決在 IC 生產或設計時的問題。
- I. 具有高度彈性的業務、行銷能力。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

①有利因素

A. 地理優勢及在地服務

展望 2026 年，全球半導體市場規模將持續成長、半導體測試介面亦持續增長趨勢下；從產業分布來看，近年全球半導體封測產業往亞太地區趨勢不變。

本公司具備國際級技術、工程、研發、商務、市場行銷及 ISO9001 認證的優勢，同時提供在地化支援、技術、交貨等服務，能提供全球半導體 IC 設計供應商完整的解決方案，以及高階測試介面(Test Interface)給予初始工程研發認證，延伸出後續封裝測試製造於台灣、中國大陸及東南亞封測大廠(OSAT)的大量需求訂單，加上在地化的即時服務和技術支援，使本公司更具備相對的優勢。

在過去幾年國際局勢與區域政治影響下，中國大陸積極發展半導體產業供應鏈自主化及在地化，晶圓代工成熟製程產能快速成長，新興 IC 設計公司和下游 OSAT 產業也隨之擴張。本公司已於 2014 年中在中國大陸蘇州成立在地化之生產基地，並於上海設置營運據點，提供最快速、最穩定之客製化測試治具服務在地客戶，如今已逾十年，規模持續擴大中。

根據 Omdia 報告指出，在 AI 投資以及 Edge AI 驅動下，2026 年中國半導體市場規模將達 5465 億美元，年增 31.26%，為大中華區推論型 AI 晶片帶來顯著成長機會，同時終端裝置中的 AI 滲透率預期將在 2026 年持續提升，同時為封裝測試帶來更多機會。由此，公司亦於中國市場持續產能，包括高階測試座及探針卡產品線產能，同時隨著半導體製程推，進而提升高階產品比重。

Source: 《OMDIA》 2026 Trends to Watch: Semiconductors | December 2025

東南亞地區亦為本公司海外布局的重中之重，本公司於 2023 年成立馬來西亞維修中心，並且於 2024 年 12 月成立馬來西亞子公司，並持續擴編中，為東南亞地區客戶提供更即時的服務，相信必能獲得更多全球 IC 設計公司及封裝測試廠之青睞，共創雙贏之榮景。

B. 產品高度客製化且主要客戶為知名半導體大廠

由於上述各項競爭優勢，本公司的主要客戶為全球高階 IC 設計公司(Design House)，同時取得與晶圓製造和封測大廠進行策略合作機會，同步開發高階以及次世代的產品技術需求，包含微細間距(Fine Pitch)之相關製程和高速/高頻測試需求所需材料，以期在後續大量生產(Mass Production)時得到快速的新產品驗證(NPI)和製程改善(Yield Improvement)，藉此拉大與競爭者產品技術和量產能力的距離。

本公司新竹垂直探針卡(Vertical Probe Card)事業單位，具備研發設計、製造生產、維修服務、產品銷售完整的服務功能，並成功通過北美等重要客戶的高階產品驗證和量產，因應客戶不同產品線的晶圓測試(Wafer Test)需求，本公司一方面能提供更高導電性之新款 Cobra 材質方案給客戶，此為其他競爭廠商所無法提供的；同時與世界一流的探針卡製造商簽供貨長約，具備 MEMS 探針卡長期的供貨能力，挹注探針卡業務。隨著全球客戶高階產品的晶圓測試需求增加，加上公司於探針卡產能的擴充，探針卡產品線營收於未來幾年將有大幅的成長。

C. AI 晶片需求增加，帶動相關測試介面需求激增，市場發展潛力大

因 AI 需求增加且應用趨廣泛，與此同時，AI、HPC 晶片設計、製造複雜度的大幅提升，封裝技術也走向新紀元，先進封裝成為半導體產業關鍵，包括扇出型晶圓級封裝(FOWLP)、2.5D/3D IC 封裝等，隨著封裝體日趨複雜，以及晶片成本提高，促使封裝前的裸晶測試(CP)，乃至後端的成品測試(FT)、系統級測試(SLT)等需求全面性提升，使得半導體測試重要性大幅提高，半導體測試介面在產業面需求激增。

D. 半導體產業為台灣重要的經濟支柱，政府政策極力支持

半導體產業係台灣經濟發展的重要推手，同時隨著地緣政治發展，半導體供應鏈韌性成為全球關注焦點，台灣半導體經過數十年的發展，台灣從 IC 設計、晶圓製造到封裝測試，不僅產業結構完整且分工精細，群聚效益(cluster effect)優勢更是領先全球，為因應貿易戰及強化台灣產業競爭力，政府積極推動相關政策，經濟部自 2022 年陸續規劃建置「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，使半導體生態更加完備。此外，行政院於 2025 年下半年推動「AI 新十大建設」，為台灣下一階段的國家級發展計畫，聚焦於人工智慧技術的應用與基礎設施。此計畫旨在從數位基磐、技術研發、產業應用等面向提升台灣的科技能量，未來將於四年投入 1,900 億元預算，推動台灣成為 AI 科技島，涵蓋智慧機器人、量子、矽光子、主權 AI 等十大技術面向，預計在 2040 年帶動新台幣 15 兆元的產值。

②不利因素與因應對策

A.全球政經前景不確定性

受到地緣政治、關稅政策、通膨等因素影響，半導體產業的成長幅度，恐受外在結構性因素影響而抵銷，且在總經環境波動、區域衝突背景下，需求端的回溫程度仍為未知數。

因應對策：

持續研發高階半導體測試解決方案，優化產品成本結構，靈活調整庫存及時應對客戶需求，關注產業趨勢，掌握產業先機。

B.在各國扶植自有半導體產業，恐間接產生排擠效益

在中美科技紛爭影響下，各國皆體認到自有半導體供應鏈的重要性，紛紛提出半導體自主計畫，強力提出有利補助方案、吸引國際半導體大廠至當地設廠，提出多項扶植半導體展業在地化的優惠政策，強化供應鏈韌性；同時衍伸各國為降低自身風險而發展在地化供應鏈、初期投資巨大，投資報酬率低下、人才荒與人力成本高昂等風險。

因應對策：

在本公司既有的全球布局下，依全球市場動向調整各地區的營運策略，複製亞洲市場的成功經驗至新開發市場；以高度客製化的設計、製造能力及彈性之生產管理，致力於提升機台規格及效能，透過提高產品附加價值，增進客戶生產效能以降低成本，進而提高客戶黏著度，在半導體測試介面技術需求面將走向微間距(Fine Pitch)、高速(High Speed)、高頻(High Frequency)、高集成(High Integrated)，亦將不斷地提升技術研發能力，建置完整的測試介面解決方案和深化在地服務，以維持競爭優勢。

C.研發人才不易培養與找尋

研發為本公司的核心競爭力之一，本公司自 2001 年成立以來，堅持技術自主，鎖定半導體高階測試介面領域相關技術開發；同時，為提升重要零組件之自製率，於 2023 年第二季度完工位於楠梓科技產業園區的第二廠，產能持續擴充中，後續人才需求大幅增加，因此半導體人才之培養與找尋亦為本公司課題。

因應對策：

本公司於 2021/1/20 在臺灣證券交易所正式掛牌上市，知名度逐步提高，有助於吸引外部優秀人才加入，藉由員工紅利配股制度、員工認股權憑證等更多彈性的員工獎勵制度以凝聚員工向心力，分享公司經營成果，留住公司核心與關鍵人才。公司於 2022 年和中山大學半導體學院合作，尤其鎖定先進半導體封測、精密電子零組件兩研究所的合作，提供實習機會，共同培育半導體人才。

同時，公司在教育訓練多所著墨注，針對產業特性為員工規劃出完善的教育訓練體系及課程，包括階層別主管才能訓練、廠內專業訓練、多能工訓練、各類專案型專業訓練、語文課程及自我管理類課程等多種項目，並鼓勵同仁參與外界舉辦之進修、研討課程，推動持續學習的觀念，旨在全面提昇人員素質、技術及加強組織對環境應變之能力，使本公司能持續在半導體測試介面產業中站穩技術領先、獲利成長的地位。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

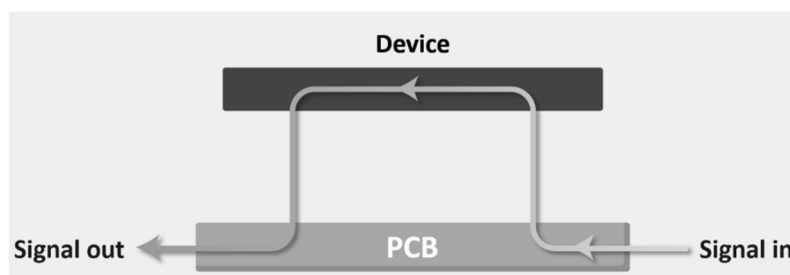
A.測試治具(Test Socket)及接觸電性元件(Contact Element)：

在半導體製程中，一個待測物(Device)經過了晶圓製程、封裝製程之後 Device 就算製作完成。完成製作的 Device 是需要被測試後才能確定性能是否正常。而本公司的產品就是提供測試時所需要的硬體介面，我們稱之為測試治具(Test Socket)。Test Socket 的功能是 Device 與測試板之間的一個介面，結構中含有重要的接觸電性元件(Contact Element)：Spring Probe，Spring Probe 的作用是提供 Device 和測試板(Test Board)的訊號傳遞。除了依據封裝的形式分類之外，Test Socket 主要架構可依照應用區分成兩件式、三件式及四件式，並搭配特殊的產品架構滿足客戶需求。除了 Test Socket，為了配合手測或偵錯(Debug)的需要，客戶也會有手測蓋(Lid)的需求。Lid 的設計會依據 Device 的大小、熱量、封裝型態有所不同，目前可支撐高達 1000W 的散熱需求。

Device 在測試的過程中又有分 Chip Probing、Final Test、Bench Test 及 Burn-in Test 幾種大類。

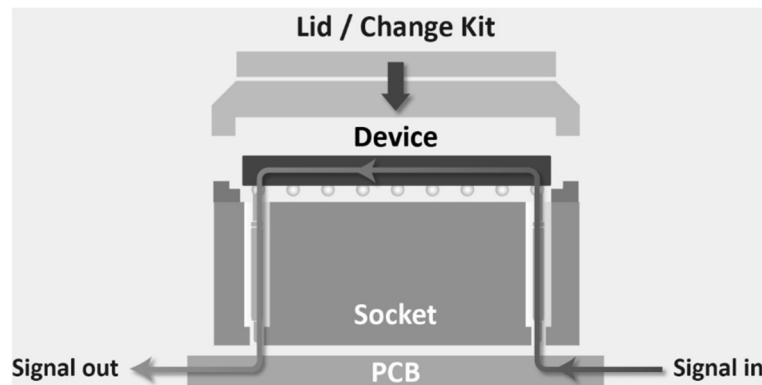
Chip Probing 也稱為 Wafer sort，屬於晶圓測試的範疇，可以根據測試需求進行 KGD(Known Good Die)的篩選，降低後續封裝的成本。

Final Test 又稱為 ATE (Automatic Test Equipment)。利用 ATE 的機台測試封裝後的 IC，測試大約 60%的 function，多組 function 可同時測試，測試時間非常快速。



測試原理：

訊號由 PCB 板傳到 Device，經過運算後傳到 PCB，再將處理過後的訊號作比對是否有達到預期的值，來判斷此顆 Device 功能是否正常。



產品功能：為了達到使測試快、狠、準我們會需要相關零件配合(先忽略機台的部分)

Contact Element：PCB 傳到 Device 訊號介質。

特性

1. 保持訊號穩定性
2. 可更換性
3. 使用壽命長

Socket：使 PCB 與 Contact Element、Device 信號傳導點的正確性。

特性

1. 定位準確
2. Device 取放快、狠、準

Lid / Change Kit：使 Device 接觸 Contact Element，進而接觸 PCB，確保訊號傳遞路線無短路現象。

特性

1. 壓貨深度準確
2. 操作簡單方便(Lid)

Bench Test 又稱為 SLT (System Level Test)。主要是 Device 上板前的測試，在這階段的測試大部分都是使用手動測試。測試項目為所有的產品在使用時的 function，如繪圖晶片就是測試顯示畫面是否正確。

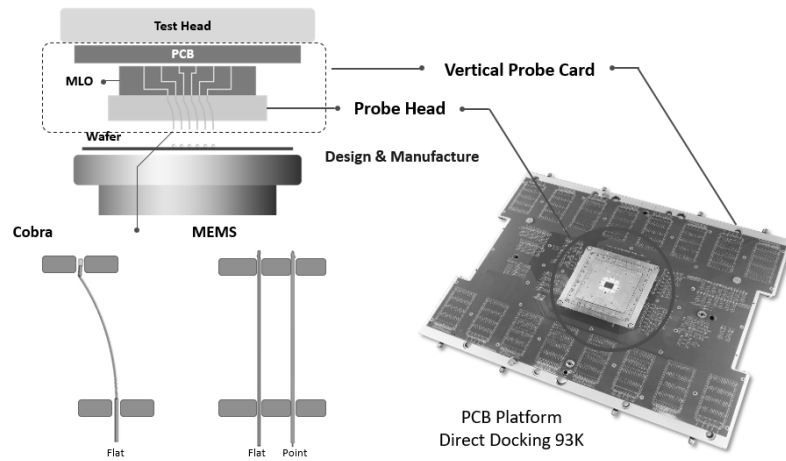
Burn-in Test: 在高溫環境中進行長時間的可靠度測試，比較常見的測試條件是 125 度測試 1000 小時及高溫高濕環境，通常用在第一批嘗試生產的 Device 上，確認晶片是否有早夭的狀況。

B. 垂直探針卡(VPC_Vertical Probe Card)：

在半導體製程中，在晶圓廠完成晶圓製作後，需在晶圓未封裝前，針對晶圓上的每一顆裸晶粒(die)，進行封裝前的「良品裸晶」(known good die; KGD)測試。以便在尚未封裝前即發現有缺陷之晶粒並予以剔除，以降低後製程的成本投入。而在測試過程中，藉由探針卡上的探針直接與晶片的鐳墊或凸塊進行接觸，量測出電路的電性，進而判斷出晶粒的好壞。垂直式探針卡可因應高針數短針距的 IC 測試市場需求，例如，覆晶技術(FlipChip in Package, FCIP)及晶圓級構裝(Wafer Level Package, WLP)產品，相較於傳統懸臂式(cantilever)探針卡，在陣列型微間距(full array type)針測有更為優異的表現。因應 AI 迅速發展，先進封裝技術(如: Chip-on-Wafer-on-Substrate, CoWoS)開始被廣泛應用，MEMS 探針卡(MEMS Probe Card)的開發則可全方面滿足客戶高階測試需求。

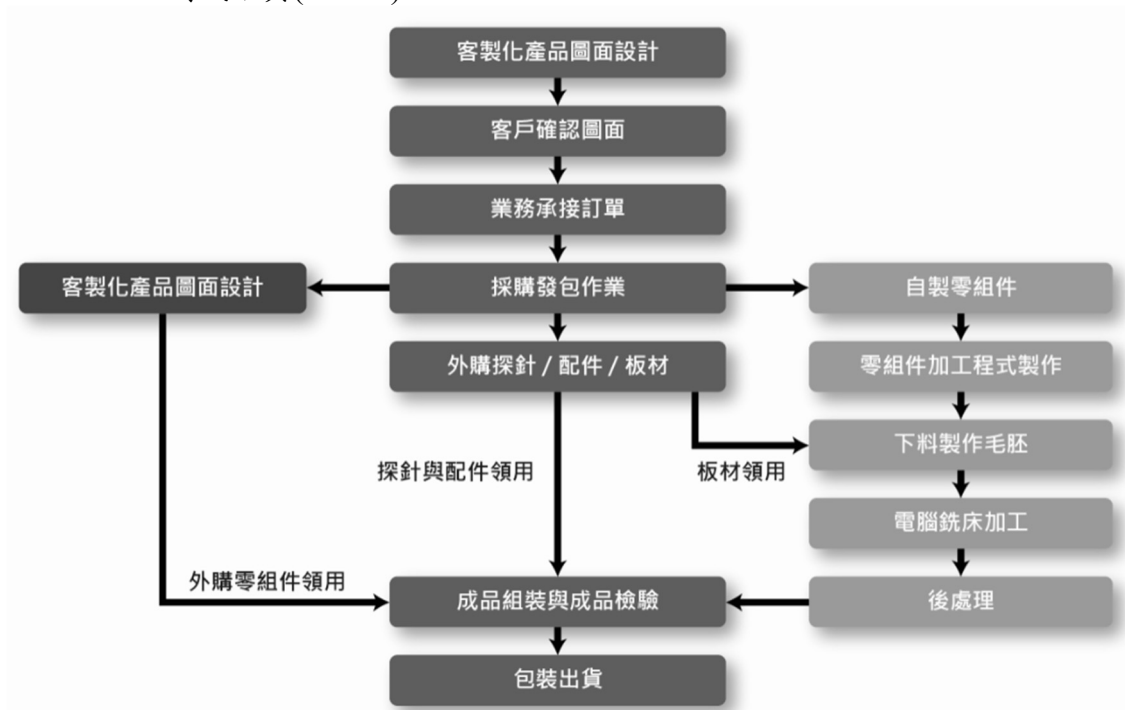
為提供客戶最佳測試方案，設計階段將會依照晶片的鐳墊或凸塊材質、尺寸、排列形式及電路資訊等，進行探針卡設計並展開 PH、PCB、Substrate 及相關 ST 零組件設計與電性模擬。

產品架構圖：

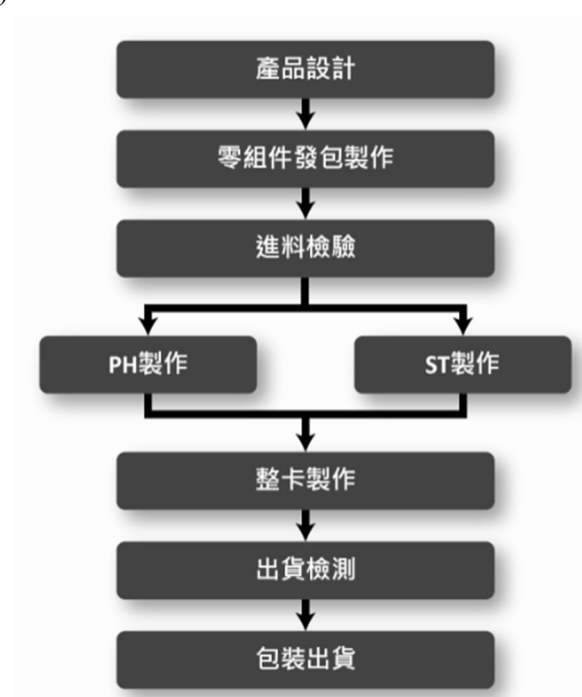


2. 產製過程

A. 測試治具(Socket)：



B.垂直探針卡(VPC)：



(三)主要原料之供應狀況

本公司與主要原料之供應商往來及配合度良好，目前供料維持正常順暢。

主要原料	主要供應廠商	供應狀況
探針	甲公司	良好
MEMS 探針卡	乙公司	良好

(四)最近二年度主要進銷貨客戶名單

1.最近二年度或任一年度曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額

單位：新台幣千元

項目	113年度				114年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲公司	765,776	30.70	無	甲公司	799,678	27.18	無
2	乙公司	98,114	3.93	無	乙公司	393,524	13.37	無
3	其他	1,630,444	65.37	無	其他	1,749,352	59.45	無
	進貨淨額	2,494,334	100.00		進貨淨額	2,942,554	100.00	

本公司主要進貨原料為製造測試介面產品所需之探針及MEMS探針卡，最近兩年度供應商之變化情形主要係隨終端產品需求增減而有所變動。本公司114年與甲公司簽訂合作備忘錄，並且與乙公司簽訂至少5年的三方長期供貨合約，採購MEMS探針卡相關產品。

2.最近二年度中任一年度曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例及增減變動原因：

單位：新台幣千元

項目	113年度				114年度			
	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與 發 行 人 之 關 係	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與 發 行 人 之 關 係
1	A 公司	798,288	13.77	無	A 公司	2,526,183	32.15	無
2	B 公司	324,128	5.59	無	B 公司	951,226	12.11	無
3	C 公司	876,041	15.11	無	C 公司	790,753	10.06	無
5	其他	3,799,639	65.53	無	其他	3,589,017	45.68	無
	銷貨淨額	5,798,096	100.00		銷貨淨額	7,857,179	100.00	

變動說明：

受惠於全球AI及HPC客戶終端應用需求強勁持續拉貨，主要客戶114年度營收較113年度顯著成長。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率

單位：人；%

年 度		113 年	114 年度	115 年 3 月 31 日
員工人數	直接人員	442	492	589
	間接人員	552	595	630
	合 計	994	1087	1219
平均年歲		34.7	35.0	34.6
平均服務年資		4.6	4.9	4.5
學歷分布 比率(%)	博 士	0.5	0.4	0.2
	碩 士	12.5	14	13.5
	大 專	75.5	77.4	78
	高 中	11.5	8.3	8.2
	高 中 以 下	0	0	0

四、環保支出資訊

最近二年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、訓練、進修、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1) 員工福利措施：

本公司秉持有滿意的員工，方有滿意的顧客理念，希望藉由充份照顧同仁身心健康，使同仁能心無旁騖並樂在工作；此外，公司由同仁組成職工福利委員會，負責各項員工福利事項之規劃與推行，目前公司之各項福利事項如下：

- A.正式員工三節獎金 2 個月
- B.季獎金
- C.依績效表現進行年度晉升及調薪
- D.員工分紅
- E.勞保、健保、勞退金提撥及團體保險
- F.年度員工旅遊補助
- G.週休二日
- H. WinIdea 提案及成效競賽
- I.部門聚餐補助
- J.同仁定期健康檢查
- K.四節禮券(春節/端午/中秋/勞動節)、生日禮券、圖書禮券
- L.各類社團活動及社團活動補助金
- M.婚喪喜慶補助金及子女獎助學金
- N.學歷提升獎勵金、在職進修學費補助與成績優良獎金
- O.廠內、外教育訓練提供及進修補助
- P.員工協助方案
- Q.每年度資深員工表揚與獎勵
- R.遠道同仁租屋津貼
- S.午餐餐費補助及免費咖啡/茶/點心/加班餐盒
- T.員工持股信託

(2) 員工訓練及進修制度：

穎歲科技深信人才是企業永續發展的關鍵，因此致力於打造完善的學習與成長機制，確保員工能夠持續提升專業技能、累積職涯競爭力，並與公司共同成長。透過內部培訓、外部學習資源、跨部門學習與人才發展計畫，幫助員工在職涯不同階段獲得適切的成長機會。

全方位的職能學習架構：為確保員工能夠在不同職涯階段獲得相應的知識與技能，穎歲建立學習藍圖，定期評估員工能力，提供相應的技能規劃與訓練課程，確保每位員工都能在工作之餘持續進步，提升專業技能與管理能力。

系統化教育訓練機制：透過年度訓練計畫、教育訓練目標、學習資源平台、課程評估與改善等機制，成為教育訓練的正向循環。

多元學習資源與外部進修支持：穎崴科技鼓勵員工透過多元管道學習，並提供相關資源，支持員工自主進修與職涯發展。公司提供員工在職進修學費補助、獎學金與學歷提升調薪，鼓勵員工參加外部課程，培養自主學習習慣，提升相關專業知識。

潛力人才發展計畫：公司為具備發展潛力及高度學習意願的員工，設計階段性的潛力人才發展計畫，提供一系列的培訓與富有挑戰性的任務，協助員工養成專業技能、專案管理與領導能力，讓其能夠在未來成為領域專家或管理職人才。

穎崴科技透過完整的教育訓練架構、明確的職能學習藍圖、多元的學習資源、潛力人才發展計畫，確保員工都能獲得適切的發展機會。穎崴對於教育訓練的投入從不吝惜。未來，公司將持續投資於人才培育，讓員工不斷進步、成就自我，同時為企業創造更大的價值。

(3) 退休制度與其實施情形：

- A. 本公司員工之適用勞動基準法退休金給予標準(舊制退休金)已於103年02月14日(公文函信勞給字第1035002213)結清年資及台灣銀行退休金準金帳戶。
- B. 本公司依據勞工退休金條例(勞退新制)提繳每月工資百分之六，至勞工個人之退休金專戶，勞工自行向主管機關領取該筆退休金退休制度年滿六十歲者即可提出申請，本公司員工退休辦法悉依勞動基準法及其相關法規訂定，由公司每月提撥「退休準備金」提存於政府指定專戶。
- C. 本公司因聘用外籍白領員工，於113年01月5日(公文函經園環安字第1120017986號)准予設立勞工退休準備金監督委員會，依月提撥率為每月薪資總額2%，提撥勞工退休準備金至臺灣銀行信託部之帳戶。

另外，自九十四年七月一日起實施勞退新制，本公司亦完成全體員工的新舊制選擇，並針對選擇新制員工及勞退新制實施後之新進員工依法每月提撥退休金，希望藉由合法與完善的退休制度，創造勞資雙贏局面。

(4) 勞資間之協議：

本公司相當重視內部溝通，除召開勞資會議以及員工溝通會議，公司內部開各種溝通管道，管理階層與員工均互相尊重，並提供意見改善，為公司成長而共同努力。截至目前為止，勞資關係和諧互信且互動良好。

(5) 各項員工權益維護措施：

本公司各項規定皆依政府法令訂定，訂有完善之制度載明各項管理規範，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討修訂制度內容，以維護所有員工權益。

本公司為全面關懷廠內員工，以達到即時照顧員工、提供問題諮詢或轉介服務，除針對狀況特殊人員進行追蹤了解並提供所需之協助外，更為加強瞭解各單位管理及人力之運作情況，定期以隨機抽樣方式舉辦員工意見懇談會。而為獲得廣泛全體員工之意見，於廠內亦設立總經理信箱，保持員工意見反應管道之順暢，期能透過各項訪談機制與通暢的溝通管道，主動發掘問題並定期審視各項管理措施與可改善之空間，建立一個能使員工快樂工作的環境。

(6) 工作環境與員工人身安全的保護措施：

- A. 制訂安全衛生守則，規範安全衛生管理事項，供員工遵循。
- B. 每半年定期實施作業環境測定(如：室內二氧化碳、有機溶劑作業場所)。
- C. 新設備、新製程皆需事先實施危害鑑別後始准員工作业。

針對員工、利害相關者之作業活動或工作環境實施安全衛生危害鑑別與風險評估，據以制訂職業安全衛生管理目標，施行相關安全衛生作業管制、緊急應變措施或教育訓練等控制措施。

- D. 依作業環境危害類型提供適當充足之防護具並督導確實配戴。
 - E. 依消防法之規定設置完整之消防系統；每半年舉行消防演練，使員工熟悉消防、逃生系統之使用；每月實施消防器材檢查並定期每年委託合格消防設備師實施消防設備檢修申報。
 - F. 針對每件工傷事故進行調查分析統計，並每月向勞動部申報。
 - G. 導入職業安全衛生管理系統(ISO-45001)，通過職業安全衛生管理系統認證，透過內外部稽核制度以確保系統有效運作。
 - H. 僱用或特約從事勞工健康服務之醫護人員，規劃員工健康管理事項。實施新人體格檢查，執行員工兩年一次定期健康檢查、每年特殊檢查，並異常者追蹤管理。
 - I. 設置足夠保健箱、急救箱、急救設備且配置急救人員。
 - J. 每年辦理健康教育訓練及員工健康促進活動。
- (二)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無

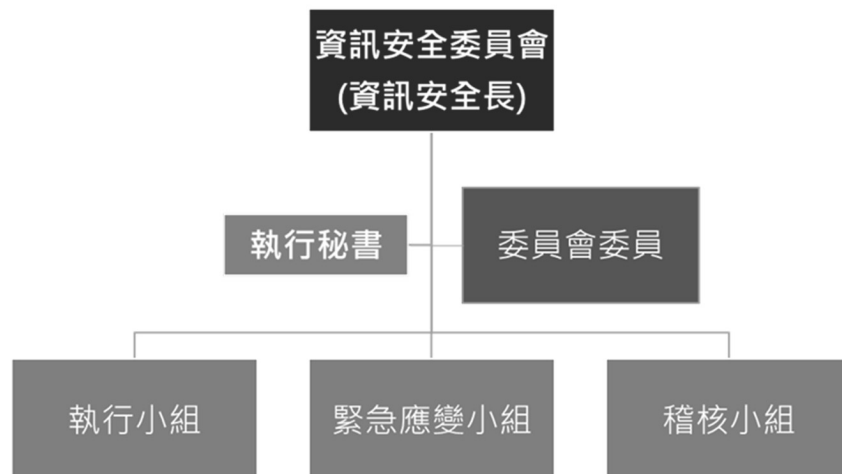
六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

1. 本公司設置【資訊安全委員會】，由總經理擔任資訊安全長兼召集人，各處級主管擔任委員會委員，委員會下設執行小組、緊急應變小組、稽核小組，本委員會負責審視各業務單位之資訊安全政策之治理、規劃、督導及執行情形，以建構出資訊安全防衛能力及同仁良好的資訊安全意識，每年並定期向董事會報告當年度執行情形：

114 年度於 8 月 28 日召開資訊安全管理制度審查會議，並於會議中向資安長及委員會成員報告 114 年資安工作報告、成果及未來展望，在 113 年至 114 年間未發生過違反資訊安全法規之事件，展現資訊安全管理的成效，使資安工作能獲得資安委員會之核准與支持。

其組織架構與工作職掌如下。



2. 【資訊安全政策】：

穎崙科技股份有限公司（以下簡稱本公司）為維護整體資訊安全及營業秘密管理，特訂本政策，以確保：

- 強化各項資訊資產之安全管理，確保其具機密性、完整性及可用性，並建立安全及可信賴之作業環境，確保資料安全、系統安全、設備安全及網路安全，保障本公司同仁與相關內、外部人員之權益。
- 強化本公司業務執行中所涉及營業秘密法第 2 條定義之創作、研發、製造等所產出之文件與檔案，確保其盡合理保護管理措施。

3. 【具體管理措施】：

資訊安全管理類型	相關作業
系統可用性	● 建置監控系統、網路可用狀態之系統 ● 建置資料異地備援系統，確保完整資訊可復原 ● 依弱點風險評估執行漏洞修補更新，改善高風險弱點 ● 定期演練災害發生，系統還原程序及演練中斷資訊服務應變措施，強化企業災難復原能力，降低營運的風險
外部威脅	● 建置防火牆及防毒牆等入侵偵測與防禦系統，偵測病毒與惡性程式攻擊，防範資訊架構及系統受損 ● 建置郵件防護系統，確保及時阻擋過濾具威脅性的郵件攻擊 ● 導入端點防毒防護，保護主機及個人電腦避免中毒與資料外洩 ● 定時電腦主機及用戶端電腦弱點檢測及漏洞修補更新
權限管理	● 人員帳號及權限之設定管理 ● 定期檢查及盤點帳號及必要業務之使用權限 ● 特權帳號與存取控管 ● 機房出入權限管理及監視管理
存取控管	● 管制資訊檔案存取 ● 建置資料存取稽核紀錄系統 ● 定義並執行檔案分級制，重要資料依規定加嚴管控 ● 僅允許經授權與合規設備可連結公司網路，公私裝置資訊資料分離

4. 【執行狀況及投入資通安全管理之資源】：

本公司循 ISO/IEC 27001 標準，執行資安相關規範並持續提升改善。114 年間由 SGS 台灣檢驗科技股份有限公司進行稽核，完成 ISO27001:2022 定期追蹤稽核重審換證並取得 ISO/IEC 27001:2022 認證，持續強化以符合現代的資安管理需求。

- 整年度投入資通安全管理之資源：115 年度資安系統及設備採購預算增長至約 1700 萬並常態性配置 5 人以上負責資安管理。
- 於 114 年 7 月進行內部資訊安全稽核，資訊部持續進行系統弱點掃描、漏洞修補、原廠已停止技術支援的作業系統伺服器及資料庫軟體升級移轉，及經評估後在無法升級的情況下，改為在主機前架設防火牆(WAF)及建置 DMZ 區放置公司主要對外服務主機，阻隔內、外部存取該主機時，可能透過高風險弱點，對主機或資料庫進行攻擊的行為。
- 公司陸續關閉不必要對外服務，改採通過 VPN 通道連線驗證後方，僅允許經授權與合規設備可連線公司內部系統服務，降低外部資訊攻擊入侵風險。
- 114 年度進行電子郵件社交工程演練乙次，並辦理"資訊安全觀念宣導"教育訓練，提升全員資安辨識能力。
- 114 年度推出 13 份資安宣導電子報及實體張貼 3 份資安宣導相關海報。

4. 【後續規劃及執行狀況】：

本公司為「維護公司資訊之機密性、完整性、可用性與適法性，避免發生人為疏失、蓄意破壞與自然災害時，遭致資訊與資產遭致不當使用、洩漏、竄改、毀損、消失等，影響本公司作業，並導致公司權益損害」。

115 年度將持續辦理數位資產保全專案(MDM、VPN)、系統弱點漏洞修補及 EOS 環境升級，並藉由伺服器防火牆、防毒措施及內網分區管控，進一步提升邊界與端點之整體防護能力；同時陸續建置威脅偵測與應變服務(MDR)及端點偵測及回應機制(EDR)與規劃導入離線備份機制，以強化設備異常行為監控、提升威脅偵測及調查回應效率，並確保備份資料之安全性。

- 藉由 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統、營業秘密法制度之規範達成資訊安全改善計畫，以及透過教育訓練與社交工程演練持續提升全員資安辨識能力期達到下列之目標。強化企業安全，降低營運風險，維持競爭力
- 以符合國際標準的角度進行資安健診、盤查潛在風險，並依據風險嚴重性逐一補強，降低資安事件對公司造成的損失
- 制定符合國際規範的資訊安全政策與日常維運作業
- 避免成為駭客攻擊企業客戶的跳板
- 提高客戶及關注方對企業穩定營運的信心與信任
- 保護客戶及公司智權
- 降低法律風險及節省成本
- 透過 ISO/IEC 27001:2013 資訊安全管理系統的運行，滿足法令、法規要求(個資法、營業秘密法、GDPR-歐盟一般資料保護規範)，減少因為資訊安全突發事件而面臨的法律問題

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實:無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃	經濟部加工出口區管理處	99/09/01~119/08/31	總公司土地租賃契約	無
租賃	經濟部加工出口區管理處	109/11/06~119/11/05	第一園區土地租賃契約	無
租賃	台元紡織股份有限公司	112/11/01~115/10/31	台元辦公室租賃契約	無
租賃	歐宜美良品股份有限公司	114/01/01~123/12/31	台中辦公室租賃契約	無
銀行授信	日商瑞穗銀行	114/2/15~116/2/15	中期放款	無
銀行授信	兆豐國際商業銀行	114/1/13~117/1/13	中期放款	無
銀行授信	玉山銀行	113/7/18~118/7/18	中期放款	無
銀行授信	中國信託銀行	自動用日起算 2 年	中期放款	檢視匯入款與存款績數
銀行授信	玉山銀行	113/2/26~120/2/15 114/11/28 已還款	中期放款 (回台投資)	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	差異	
	金額	金額	金額	%
流動資產	5,045,430	6,426,346	1,380,916	27.37
不動產廠房及設備	2,256,431	2,206,048	(50,383)	(2.23)
使用權資產	119,848	118,333	(1,515)	(1.26)
投資性不動產	-	-	-	-
無形資產	37,528	51,142	13,614	36.28
其他資產	120,772	242,337	121,565	100.66
資產總額	7,580,009	9,044,206	1,464,197	19.32
流動負債	1,812,377	2,524,213	711,836	39.28
非流動負債	227,728	74,684	(153,044)	(67.20)
負債總額	2,040,105	2,598,897	558,792	27.39
股本	358,238	360,416	2,178	0.61
資本公積	3,105,988	3,343,862	237,874	7.66
保留盈餘	2,152,597	2,935,423	782,826	36.37
其他權益	(76,919)	(194,392)	(117,473)	152.72
權益總額	5,539,904	6,445,309	905,405	16.34
重大變動項目說明(變動比率達20%以上，且其變動金額超過新台幣一仟萬元者)： (1)流動資產增加：主係114年度營業收入上升應收帳款增加所致。 (2)無形資產增加：主係114年度購入模擬分析用軟體所致。 (3)其他資產增加：主係114年度預付購置設備款增加所致。 (4)流動負債增加：主係114年度營業成本上升應付帳款增加所致。 (5)非流動負債減少：主係114年度償還長期借款所致。 (6)其他權益減少：主係114年度發行限制員工權利新股所致。				

二、財務績效

財務績效比較分析表

單位：新台幣千元；%

年度	113 年度	114 年度	增(減)金額	變動比率
會計科目	金額	金額		
營業收入	5,798,096	7,857,179	2,059,083	35.51
營業成本	3,264,561	4,300,706	1,036,145	31.74
營業毛利	2,533,535	3,556,473	1,022,938	40.38
營業費用	1,165,392	1,486,878	321,486	27.59
營業利益	1,368,143	2,069,595	701,452	51.27
營業外收入及支出	66,439	(8,387)	(74,826)	(112.62)
稅前淨利	1,434,582	2,061,208	626,626	43.68
所得稅費用	248,745	388,336	139,591	56.12
本期淨利	1,185,837	1,672,872	487,035	41.07
本期綜合損益總額	1,196,501	1,676,564	480,063	40.12
最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動（變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者）：				
主係受惠於全球AI及HPC客戶終端應用需求強勁持續拉貨，營業收入、營業純益及稅前純益大幅增加。				

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析：

單位：新台幣千元；%

項 目	年 度	113 年度	114 年度	增(減)金額	增(減)比例%
營業活動之淨現金流入(出)		1,048,961	1,802,778	753,817	71.86%
投資活動之淨現金流入(出)		(1,084,460)	722,182	1,806,642	(166.59%)
融資活動之淨現金流入(出)		516,069	(1,057,455)	(1,573,524)	(304.91%)
合計		480,570	1,467,505	986,935	205.37%
變動分析：					
(1) 營業活動：本期營業活動為淨現金流入增加753,817仟元，主要係114年營收大幅增加所致。					
(2) 投資活動：本期投資活動為淨現金流入增加1,806,642仟元，主要係114年按攤銷後成本衡量之金融資產增加所致。					
(3) 融資活動：本期融資活動為淨現金流出增加1,573,524仟元，主要係114年發現金股利所致。					

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初現金 餘 額	預計全年來自營運 活動淨現金流量	預計全年來自投資 活動淨現金流量	預計全年來自融資 活動淨現金流量	預計現金剩餘 (不足)數
2,593,851	1,357,439	(1,286,266)	2,235,152	4,900,176
1. 未來一年度現金流量變動情形分析：				
(1) 營業活動：主係預計 115 年度因營收成長，獲利增加，致營業活動淨現金流入。				
(2) 投資活動：主係預計 115 年度資本支出等。				
(3) 融資活動：主係預計發行公司債所致。				

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資政策：

近年來本公司基於營運需求及未來發展等因素積極拓展海外市場，故陸續進行相關之海外轉投資事業，以提供當地產品行銷及技術支援等服務，未來投資計畫仍須視各轉投資事業之營運情形及公司策略等因素進行相關評估。本公司目前訂有「取得或處分資產管理辦法」以及「對子公司監督與管理」等規範並能落實各項管理機制之執行，以使各轉投資事業能發揮最大之經營績效。

(二)獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

114年12月31日 單位：新台幣千元

公司別 \ 項目	持股 比例	投資 金額	被投資公司 本期(損)益	獲利或虧損之 主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
WINWAY INTERNATIONAL CO., LTD.	100%	204,599	101,286	營運狀況正常	-	-
磐時電子科技 (蘇州)有限公司	100%	204,599	101,286			
WINWAY MALAYSIA SDN. BHD.	100%	(註)	-			
WINWAY TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC.	100%	18,889	19,529			

(註)於民國一一四年設立登記於馬來西亞，截至民國一一四年十二月三十一日止，尚未注資該公司。

六、風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動

本公司 113 年度及 114 年度利息費用分別為 14,526 仟元及 3,916 仟元，佔當年度營業收入淨額比率分別為 0.25%及 0.04%，所佔比例不高，故利率變動對本公司並無重大影響。

本公司基於穩健保守之財務管理基礎下，將維持良好的財務結構及償債能力，做為對金融機構議價及談判的有利籌碼；並與各銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率，另亦將多方參考國內外各經濟研究機構及銀行研究報告，持續觀察利率走勢，並與往來銀行保持暢通之聯絡管道，隨時掌握當前利率水準。

2.匯率變動：

本公司 113 年度及 114 年度外幣兌換(損)益分別為 48,010 仟元及(65,820)仟元，佔當年度營業收入淨額比率分別為 0.82%及(0.83%)，所佔比例不高，故匯率變動對本公司並無重大影響。

本公司產品外銷以美元為報價基礎，而向國外採購之原料亦以美元作為主要計價單位，故國際美元走勢與公司之匯兌損益息息相關，為規避匯率波動對獲利可能造成之影響，本公司對外匯風險之管理採取之具體措施如下：

- A.與往來銀行保持良好的互動關係和密切聯繫，財務人員隨時注意外匯市場變化情形，並且適時地調整公司外幣持有部位，掌握結匯之最佳時機。
- B.隨時注意匯率走勢，業務部門報價時，須考量匯率波動對銷售價格之影響性，當產生波動時，與客戶端進行協調，適時反映於產品報價，儘可能將匯兌風險降至最低。

3.通貨膨脹：

本公司將持續致力於各項成本之降低，密切注意原、物料之供需與價格變動狀況，適時調整庫存；研發低成本之替代料源，並力求降低營運成本，以期降低對損益之影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司訂有「取得或處分資產管理辦法」及「資金貸與他人及背書保證管理辦法」，業經股東會決議通過，為本公司執行相關交易之依據。
- 2.本公司以專注經營本業為基礎，且基於保守穩健之原則，截至年報刊印日止並無從事高風險、高槓桿投資、背書保證及衍生性商品等交易。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1.未來研發計畫：

研發重點產品	計劃目標
微間距探針卡 (Fine Pitch Probe Card)	高精度探針卡機構設計、精密孔徑加工技術與高性能接觸元件開發
高速暨高頻同軸測試治具 (Brownie Coaxial Socket)	優化 Brownie Coaxial Socket 電氣特性，提高測試頻率以及維持訊號探針阻抗匹配性。
高效率主動式溫度控制器 (Thermal Control Equipment)	提高致冷能力以及溫控技術，達到廣溫域控制
客製化老化測試治具 (Customized Burn-in Socket)	提供客製化高性能老化測試 Socket 解決方案
接觸元件設計、製造與材料開發 (Design, fabrication and material development of contact element)	從材料評估、元件設計到製造建立完整流程，滿足各式測試需求
基板,載板設計和組裝 (Substrate, Load Board Design & Assembly)	因應客戶高端測試需求，提供基板,載板設計及廠內組裝檢測能力
MEMS 探針卡 (MEMS Probe Card)	提供不同測試 Stage 對應針款的探針卡方案，及開發高階測試需求之 MEMS 探針卡
探針組裝自動化設備 (Probe Assembly Equipment)	整合微米級視覺補償與智慧機械手，提升單、雙動式探針組裝良率與產能，並導入品質監控與數據回饋系統，建構低成本、高效率之智慧自動化產線，極大化營運價值

MEMS 探針卡自動量測機 (MEMS Probe Card Automated Measurement System)	導入自動化電性與物理特性量測系統，精準宣告 FDR、CCC 及 MAC 關鍵規格，並透過數據智慧化檢測確保產品一致性，建立高階品質競爭力
超大封裝高速暨高頻同軸測試治具 (Large-scale Packag Brownie Coaxial Socket)	從材料開發、優化設計到提升製造技術，優化超大封裝 Warpage，提高測試頻率以及維持訊號探針阻抗匹配性。
高效率主動式溫度控制器 (Thermal Control Equipment)	提高致冷能力以及溫控技術，達到廣溫域控制。
高功率被動式散熱器 (Electronic Vapor Chamber HeatSink)	提高散熱能力以及 VC、熱管製程技術，達到客戶晶片測試溫度需求。
智慧型溫度控制設備 (Intelligent temperature controller)	因應客戶超大封裝溫控需求，提供動態多點式 Tc/Tj 智慧解決方案。 開發自我診斷系統，提供客戶預測性維護決策。
熱管理暨簡易測試分選機 (Thermal Control user-friendly Test Handler)	因應客戶超大封裝測試高下壓力需求，提供熱管理暨 Plunger 整合方案。
接觸元件設計、製造與材料開發 (Design, fabrication and material development of contact element)	從材料評估、元件設計到製造建立完整流程，滿足各式測試需求。 利用有機與無機填充物或介質，提升導電膠之電氣、耐溫與機械特性。
微間距薄板設計和製造 (Fine Pitch Thin Plate Design & Manufacturing)	因應客戶高端測試需求，開發高精度薄板設計及廠內製造技術能力。

2. 預計再投入之研發費用：

本公司投入之研發費用係依據市場長期需求所規劃的新產品及新技術開發進度逐步編列，近年約佔營業收入之6%，115年預計投入研發支出約佔營業收入6%，本公司為確保本公司競爭優勢，將視營運狀況及需求隨時調整，提高未來研發經費佔營業收入之比重，以強化研發新品之產出。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司營運均遵循國內外相關法令規定，且隨時注意國內外重要政策發展趨勢與法規變動情形，以即時提供相關資訊給管理階層，作為因應國內外政經情勢變動之參考依據，因此本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務及業務之情事。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司不斷地提升生產技術，加強生產及製程管理，提高生產力及產品良率，開發利基產品，並隨時視終端產品市場供需變化情形調整產品策略，以降低科技改變及產業變化對本公司財務業務面之衝擊與影響。另本公司平時即密切注意所處行業之產業狀況及相關新興科技，以隨時因應科技或產業之變化，並做適當之經營調整，故預期應能有效降低其影響，本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無因科技改變及產業變化而有影響財務及業務之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，即秉持永續經營之理念，謹守政府法令規章，持續提升經營管理及產品品質，並適時提供客戶最佳的服務，全體員工盡力達成獲利目標，以善盡對全體股東之責任。未來本公司仍將持續致力產品品質之提昇，維持一貫良好之企業形象，提昇公司在半導體產業供應鏈之地位，讓本公司的產品及服務，獲得更多客戶的肯定，因此本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無因企業形象改變對企業危機管理造成重大影響之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無任何併購計畫，若未來有進行併購計畫時，將審慎評估並考量併購綜效，以確保原有股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司現有廠房使用率已高且產能利用率已近滿載，為掌握市場成長趨勢，需擴充廠房並增購機器設備以提升中長期競爭力。本公司廠房之擴充皆經過完整及審慎之評估，已充分考量投資回收效益及可能風險，並將隨時評估產業變化，以降低營運風險。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.銷貨方面：

本公司除與既有客戶建立良好而穩定之合作關係外，亦持續開發新產品及拓展新客戶，本公司114年度向A公司銷售之金額占當年度銷貨淨額比重為32.15%，對單一客戶之銷貨比率超過30%，有銷貨集中之情事。A公司為美國上市公司為全球知名大廠，專門從事IC設計公司，與本公司已建立長期合作關係，由以往交易歷史得知，A公司付款情況尚屬穩定，並無款項逾期之情形，本公司持續拓展其他新客戶，以降低進貨集中之風險。

2.進貨方面：

本公司主要採購原料為製造測試介面產品所需之探針及微機電探針卡（MEMS）等，對於供應商的選擇，係以產品交期、品質及價格為考量，以符合客戶需求，本公司114年與甲公司簽訂合作備忘錄，並且與乙公司簽訂至少5年的三方長期供貨合約，採購MEMS探針卡相關產品。

本公司113年度及114年度向甲公司採購之金額占當年度進貨淨額比重分別為30.70%及27.18%，對單一供應廠商之進貨比率超過30%，有進貨集中之情事。甲公司為日本上市公司之在台分公司，專門從事IC半導體測試座、測試探針、汽車無線通訊、手機簧片連接器、電子相關零組件生產製造及銷售，與本公司已建立長期合作關係，由以往交易歷史得知，甲公司供貨尚屬穩定，並無供貨中斷或短缺之情形。惟本公司為避免因不可抗力事件造成原料中斷或短缺，除購買甲公司之材料外，持續開發其他替代供應商，以維持兩家以上供貨來源，並透過持續提高自製比例，以降低進貨集中之風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司董事、監察人及持股超過百分之十之大股東於最近年度及截至年報刊印日止，持有股數變化不大，尚無股權大量移轉或更換之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件：

- 1.公司截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

旺矽科技股份有限公司（下稱「旺矽公司」）先於民國（下同）106年11月間，對於本公司及其法定代表人王嘉煌董事長，以及本公司數名員工提起營業秘密法等之刑事告訴，經檢察官於109年5月間對王嘉煌董事長及員工三人不起訴後，起訴員工四人及本公司（下稱「第一刑事訴訟」）；次於108年9月19日，對本公司及上述人員提起營業秘密損害賠償等事件之民事訴訟（下稱「第一民事訴訟」），旺矽公司於109年12月間旺矽公司提高請求賠償金額至新台幣1億5891萬元。第一刑事訴訟臺灣新竹地方法院於民國一一四年一月二十三日判決本公司無罪，旺矽公司上訴至由智慧財產及商業法院分案審理中，第一民事訴訟截至民國一一五年三月三十一日止由臺灣新竹地方法院勞動專庭審理中，仍於續行鑑定事項確認之階段，尚無法判斷其最終可能之結果。

旺矽公司復再以其他事實提出刑事告訴（下稱「第二刑案」），本案經新竹地檢署為不起訴處分後，旺矽公司提出再議，嗣經高等法院檢察署於112年9月15日發回續行偵查；本公司復於民國一一三年八月九日收受旺矽公司向智慧財產法院對於本公司及負責人、十五名員工、董事長王嘉煌及四名離職員工（未曾任職旺矽公司）提起民事訴訟（下稱「第二民事訴訟」），請求本公司連帶給付200,000千元，目前由智慧財產及商業法院審理中，截至民國一一五年三月三十一日止，本訴訟尚於準備程序階段，尚無法判斷其最終可能之結果。

本公司於民國一一四年四月二十一日收到旺矽科技股份有限公司（以下簡稱「旺矽公司」）向智慧財產及商業法院具狀對本公司及負責人提起特定型號垂直式探針卡侵害其專利權之民事訴訟（下稱「第三民事訴訟」），向本公司連帶求償38,250千元，並請求全數收回並銷毀侵權產品，目前由智慧財產及商業法院審理中，本案尚於準備程序階段，尚無法判斷其最終可能之結果。

本公司主要產品多為高度客製化之產品，且一向尊重智慧財產權並致力於技術之研發，並無旺矽公司所陳述不法取得或使用其營業秘密之情事。

- 2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：同1.訴訟事件之說明。

(十三) 其他重要風險及因應措施

無。

七、其他重要事項:無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

請參考公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>

單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 無。

三、其他必要補充說明事項 無。

柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：同第108頁訴訟事件之說明。

穎歲科技股份有限公司

負責人：王嘉煌



